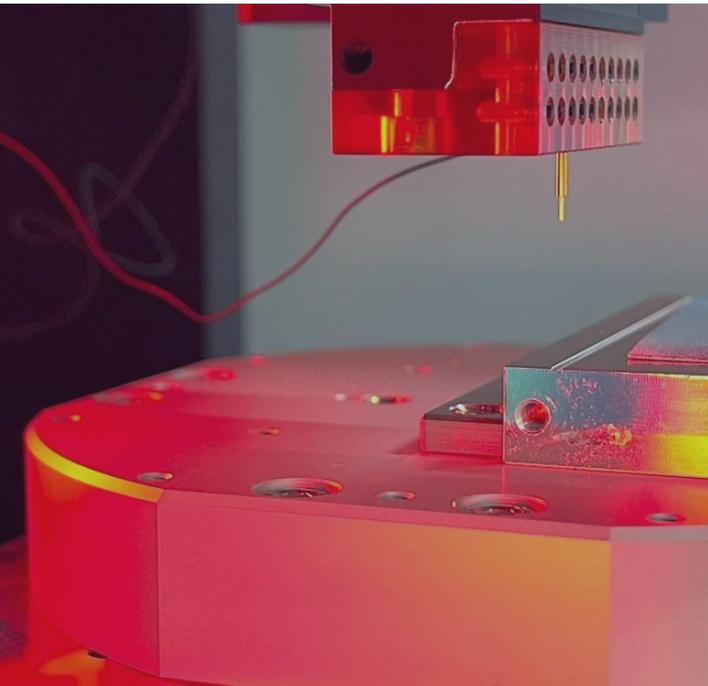
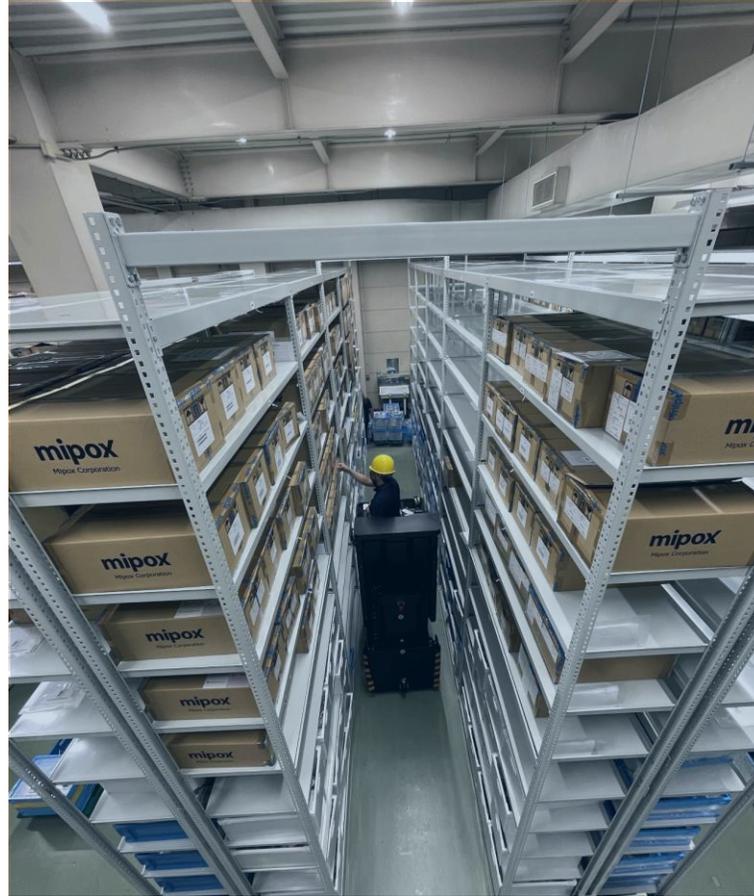


2024年3月期 第3四半期決算説明資料

Mipox株式会社(マイボックス) 証券コード 5381

2024年2月13日

Agenda



01 会社概要

02 2024年3月期第3四半期 実績

03 通期業績見通し

04 事業内容

05 競争力の源泉

06 成長戦略

07 Appendix

会社名	Mipox (マイボックス) 株式会社
英文名	Mipox Corporation
創業	大正14年 (1925) 年11月21日
設立	昭和16年 (1941) 年12月12日
代表取締役社長	渡邊 淳 (Jun Watanabe)
本店・本社	〒322-0014 栃木県鹿沼市さつき町18
株式市場名	東京証券取引所 スタンダード
証券コード	5381



経営方針

エンジニアリングアプローチによる製品事業の付加価値向上



受託事業から
エンジニアリングサービス事業への転換

早い変化と多様性に対応できる
経営基盤の整備

「塗る、切る、磨く」を極めた技術力

創業から続く箔の製造技術を応用することで「塗る」「切る」「磨く」技術をコアにした事業を展開した企業です。

コア技術を組み合わせ、お客様の成功のための付加価値を創造するための製品とサービスを提供します。

塗る

Coating

PETフィルム、銅箔、織布、紙等の基材に、調合した樹脂等の塗料を均一に塗布。

自社製品である研磨材や反射材だけでなく、保有する複数の塗工機によってご要望に合わせた機能性フィルムの製造も実現。

切る

Slitting

「塗る」ことで出来た製品を希望のサイズに裁断(スリット)。

高精密さが求められるハードディスク向け研磨フィルムの製造で培った技術によって、裁断が困難といわれている素材でも精度の高い切り口と巻き上げを実現し、高品質の製品を提供。

磨く

Polishing

徹底的な顧客視点を持った製品開発のために自社の研磨材と独自の研磨装置で研磨プロセスの研究を積み重ねる。

ハイテク分野で培った高精度研磨加工技術で次世代半導体ウェーハの研磨にも挑戦し、研磨市場に於けるプロフェッショナルを目指します。

拠点開設		事業領域	売上高(百万円)		トピックス
1925	東京都京橋区にて設立	製品事業 受託事業			顔料と色箔の輸入業者としてドイツ資本により設立(独逸顔料合名会社)
1981					日本マイクロコーティング(株)へ商号変更
2001				6,858	JASDAQ店頭市場に上場
2002			4,439		
2003			4,949		
2004			7,197		
2005			10,799		
2006			8,966		
2007			8,329		
2008			6,083		
2009			3,238		2009年3月期 渡邊淳が代表取締役社長に就任(現代表)
2010			3,013		受託事業強化
2011		3,157			
2012	インド、中国(上海)	3,045			
2013	フィリピン	2,815	594	3,409	Mipox(株)へ商号変更、本社を東京都立川市へ移転
2014	台湾	3,202	558	3,760	
2015	京都府京都市	3,606	379	3,985	日本レフライト工業(株)を子会社化、Mipox Kyoto(株)を設立
2016	ベトナム、広島県福山市	3,930	274	4,204	日本研紙(株)を子会社化
2017		6,219	190	6,410	Mipox Kyoto(株)を吸収合併
2018		7,009	816	7,826	
2019		7,083	474	7,558	日本研紙(株)の営業機能を統合
2020	中国(深セン)	6,832	506	7,338	Ref Liteのリブランド
2021	広島県呉市	6,416	944	7,361	本店を山梨県北杜市へ移転、日本研紙(株)を吸収合併、オムニ・カーボナイト事業を吸収分割
2022	栃木県鹿沼市	7,570	2,879	10,449	ミスミ化学(株)を子会社化、本社を東京都四谷に移転
2023		7,948	2,080	10,029	本店本社を栃木県鹿沼市へ移転、(株)スガ コーディングスの粉体塗装事業を譲受

製品事業

研磨材の製造・販売

売上高
構成比 **79%**

■ ハイテク関連製品 **37%**

HDD関連、半導体、光ファイバー等で使用される
研磨材の製造・販売

■ 一般研磨関連製品 **42%**

自動車、鉄鋼関連等で使用される
研磨材の製造・販売

受託事業

顧客から材料の支給を受け
当社グループが保有する設備で受託加工

売上高
構成比 **21%**

■ 受託塗布・スリット **15%**

顧客からフィルムや塗料材等を預かり、
当社設備を使用して加工製造

■ 受託研磨加工 **5%**

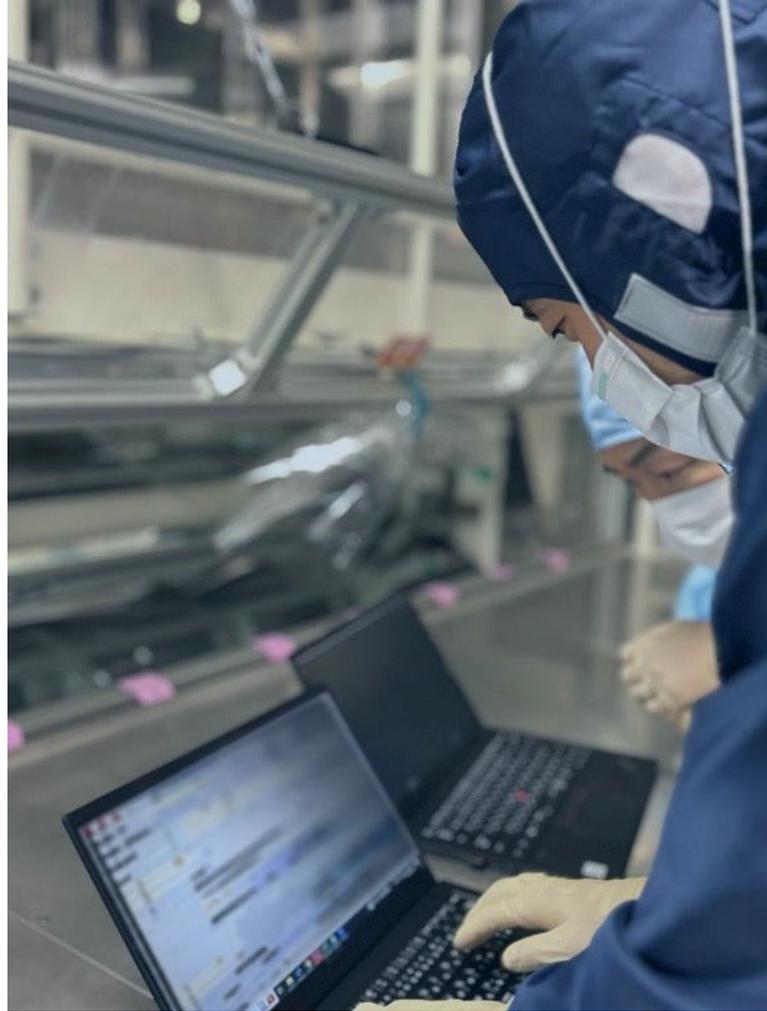
半導体用途を中心にウェーハ等の材料を預かり、
当社の研磨材と設備を使用して研磨加工



国内外売上高比率(2023年3月期)



Agenda



- 01 会社概要
- 02 2024年3月期第3四半期 実績
- 03 通期業績見通し
- 04 事業内容
- 05 競争力の源泉
- 06 成長戦略
- 07 Appendix

売上高

6,644百万円

前年同期比較

1,108百万円減少 (▲14.3%)

営業利益

▲462百万円

前年同期比較

712百万円減少 (-%)

経常利益

▲322百万円

前年同期比較

810百万円減少 (-%)

親会社株主に帰属する
当期純利益

▲348百万円

前年同期比較

534百万円減少 (-%)

自己資本比率

46.3%

前年同期比較

3.1pt減少

業績概要

世界的な経済活動の正常化が進み、緩やかに回復基調の顧客マーケットも出てまいりました。ただ、当社の主要マーケットであるハードディスク等は、データセンター向け投資の回復に時間を要しているなど、ハイテク関連製品を中心に停滞が見られました。これらマーケットの影響もあり、売上高は6,644百万円(対前年同期比1,108百万円減少)、営業損失は462百万円(712百万円減少)、経常損失は322百万円(810百万円減少)、当期純損失は348百万円(534百万円減少)となりました。

減益要因

第3四半期から利益は回復傾向です。一部ハイテク関連製品の需要の戻りや、新たに取得した大久保鉄工所の売上貢献などもあります。引き続き通期では各段階利益で損失を計上しております。

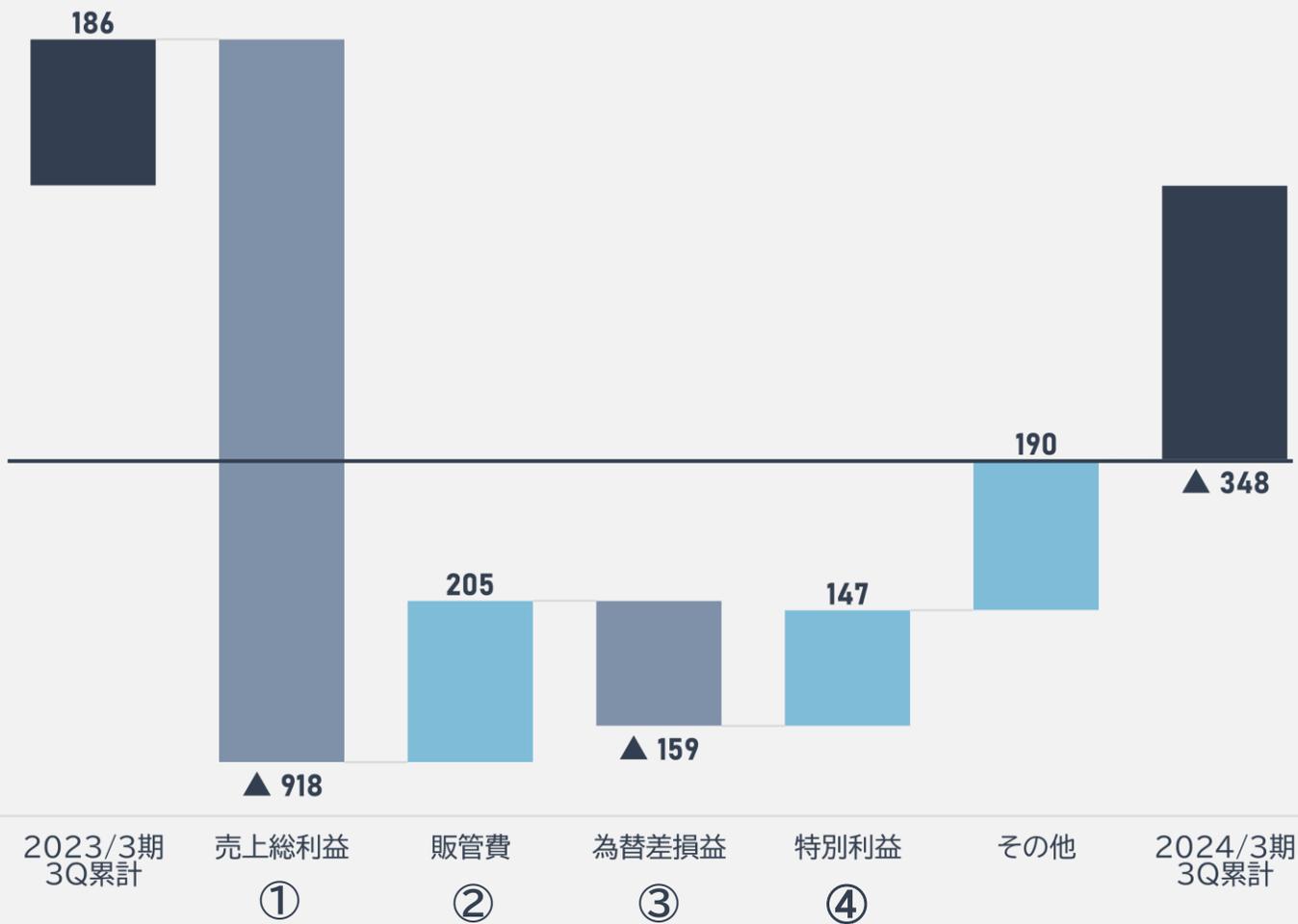
※増減算出後、百万未満切捨て

(単位:百万円)

	2023/3期 3Q	2024/3期 3Q	前年同期比
売上高	7,753	6,644	▲14.3%
売上総利益	2,752	1,833	▲33.4%
販売費及び一般管理費	2,502	2,296	▲8.2%
営業利益	249	▲462	-
為替差益	208	48	▲76.7%
経常利益	488	▲322	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	186	▲348	-

※百万円未満切り捨て、業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

(単位:百万円)



※増減算出後、百万未満切捨て

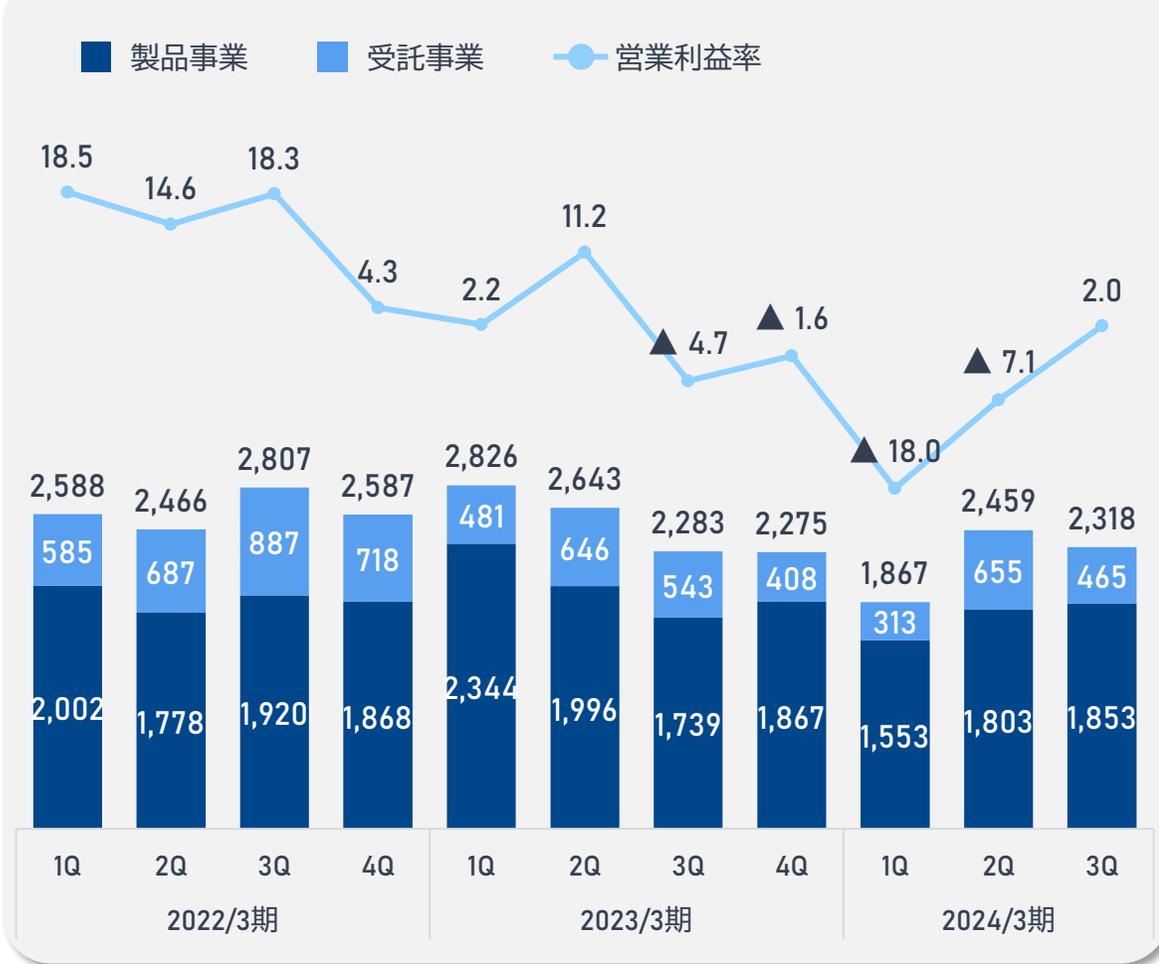
利益減少要因

- ① 第3四半期の売上高では、製品事業が対前年同期比で増加、受託事業が減少し、粗利率も改善傾向にあります。ただし、第3四半期累計では、上半期の対前年同期比売上高および売上総利益のマイナス影響が大きく、引き続き売上総利益ベースで大きく減益しています。
- ② 変動費である物流費用を中心に販管費が減少しております。鹿沼事業所の物流機能を活用し、他拠点で契約している外部倉庫の解約を進める等によるコスト削減も進めております。
- ③ 為替の変動がありますが、円安傾向が継続しており、2024年3月期も為替差益のポジションにありますが、対前年同期比では減少いたしました。
- ④ 中国子会社の清算や京都工場の売却益を計上しております。

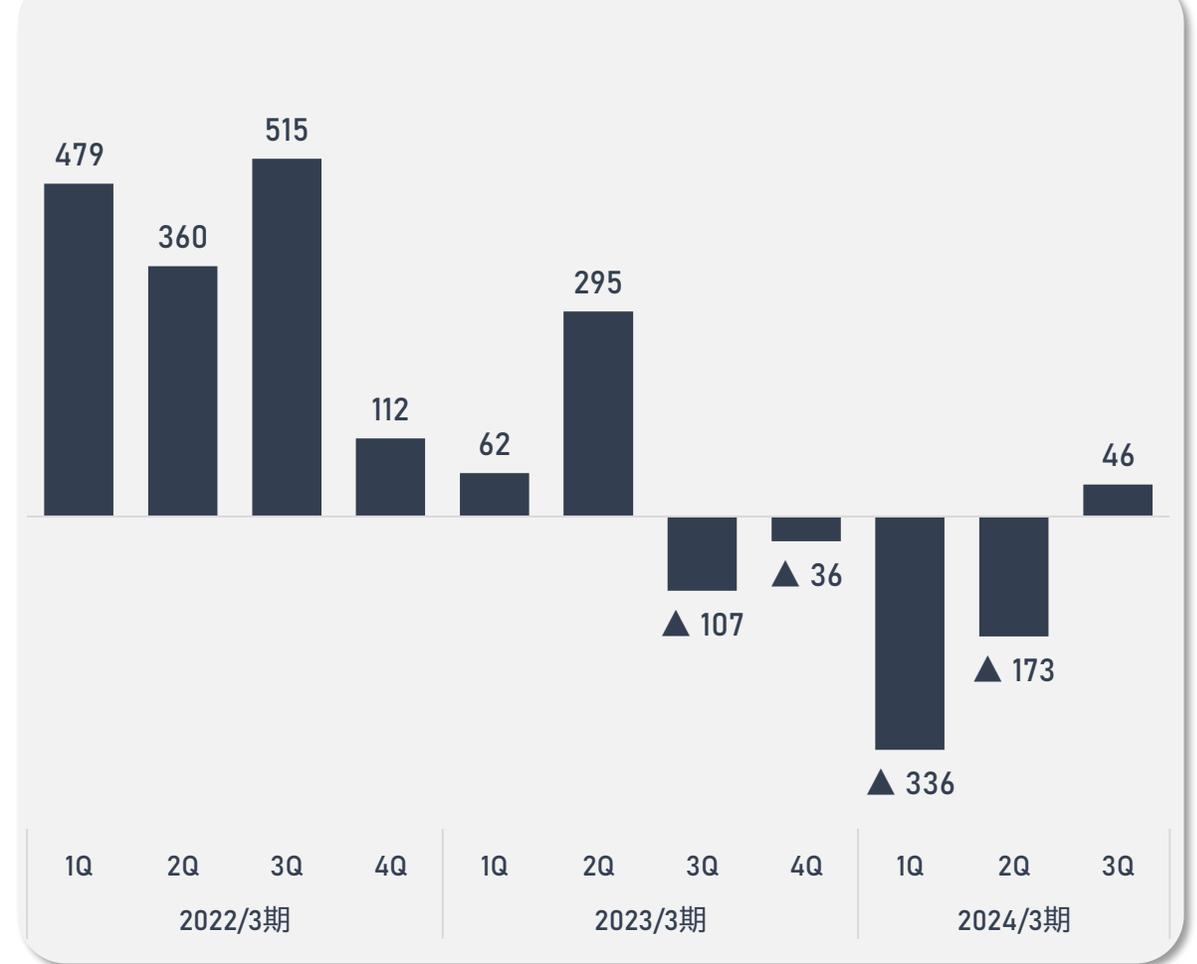
02 業績推移(連結)

- 製品事業は引き続き回復傾向です。一方で、受託事業は季節性もありますが、売上および利益共に減少傾向です。
- 第3四半期から製品事業が牽引し、営業利益を計上しています。

売上高・営業利益率(単位:百万円・%)



営業利益(単位:百万円)

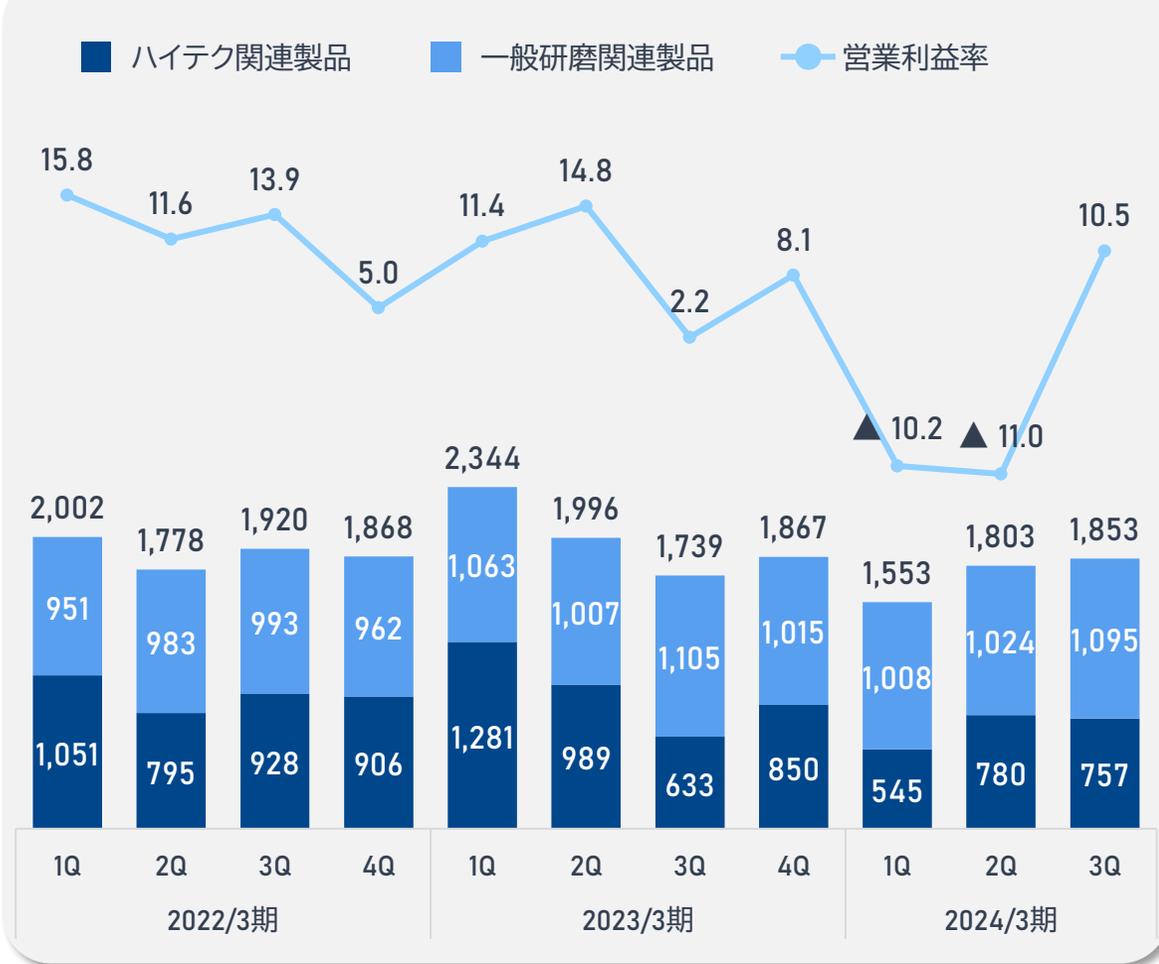


※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

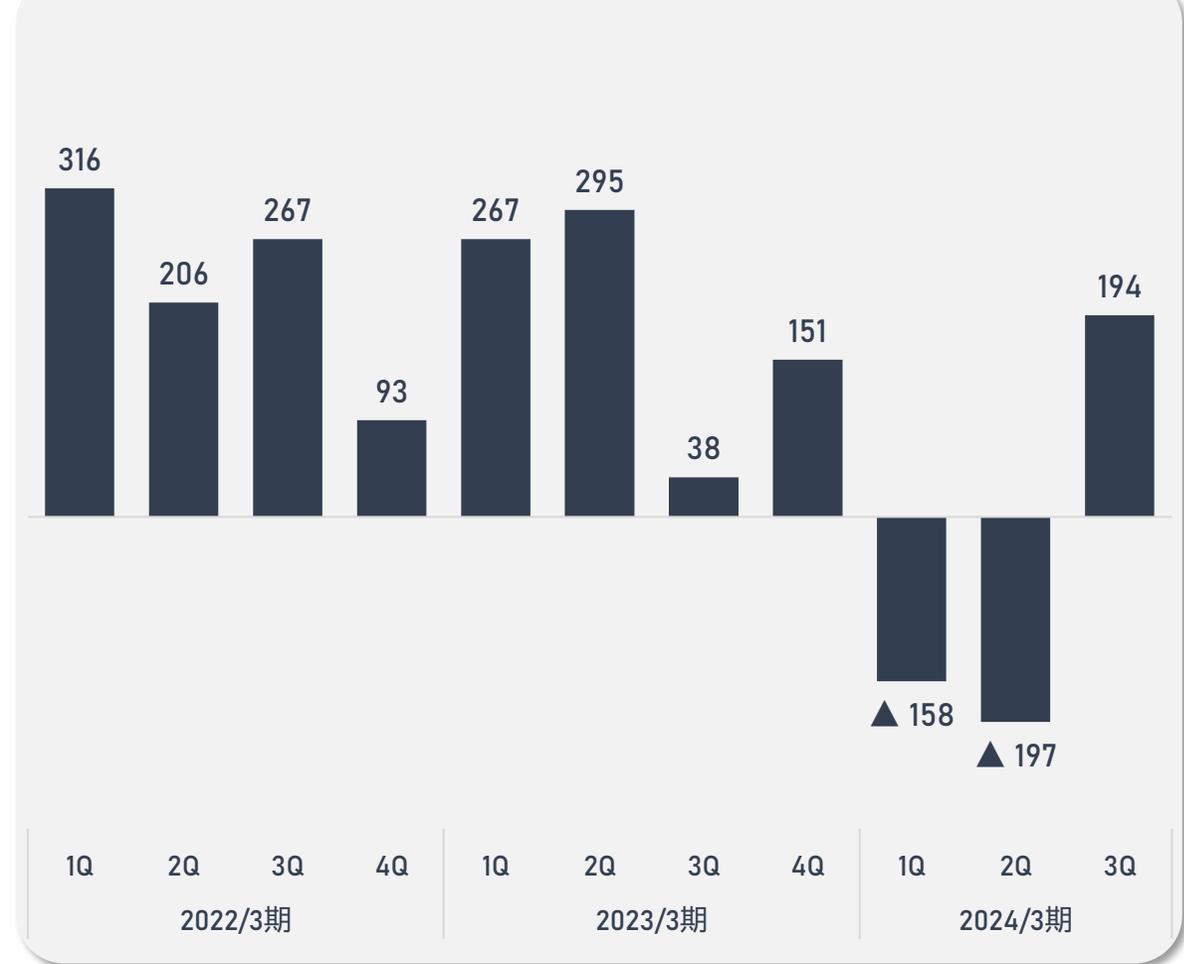
02 業績推移(製品事業)

- 一般研磨関連製品は安定的な推移を維持しています。ハイテク関連製品は一部の用途で回復の兆しが見られます。
- セグメントで営業利益を計上しています。利益率の高い製品の売上高増加や、棚卸資産評価損の減少等が主な要因です。

売上高・営業利益率(単位:百万円・%)



営業利益(単位:百万円)

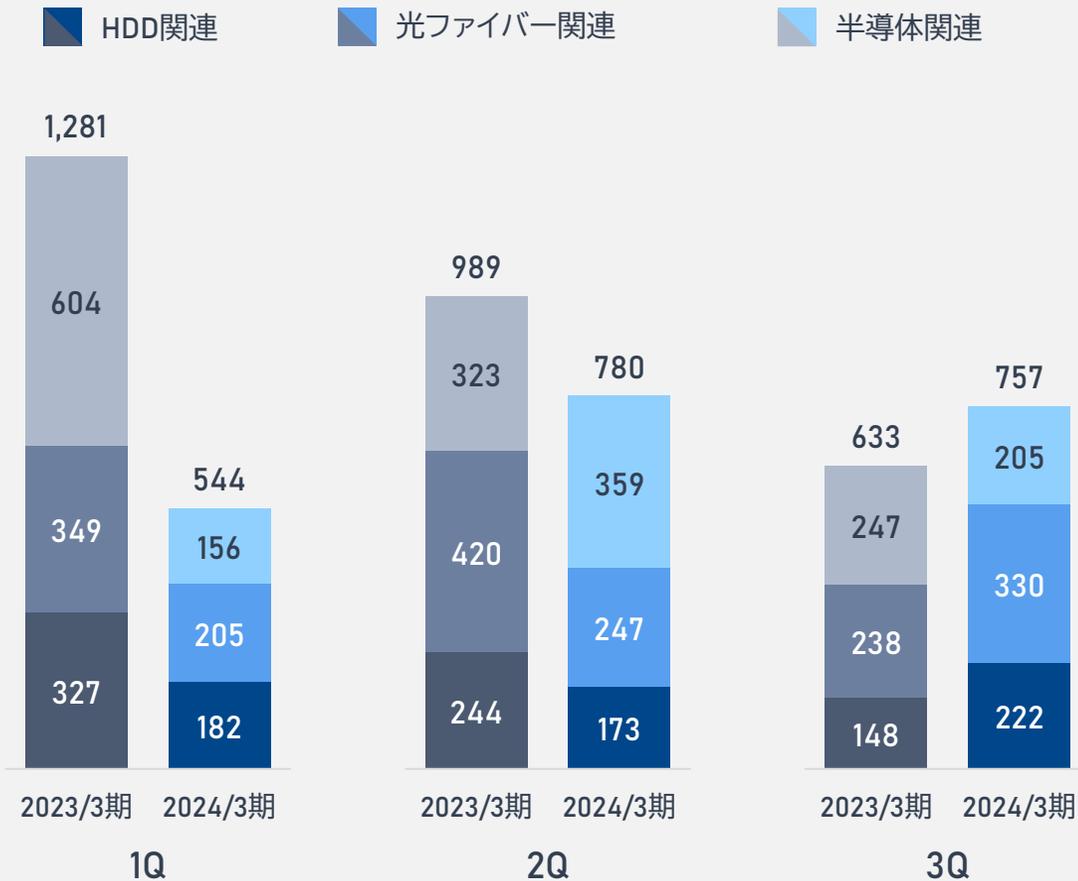


※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

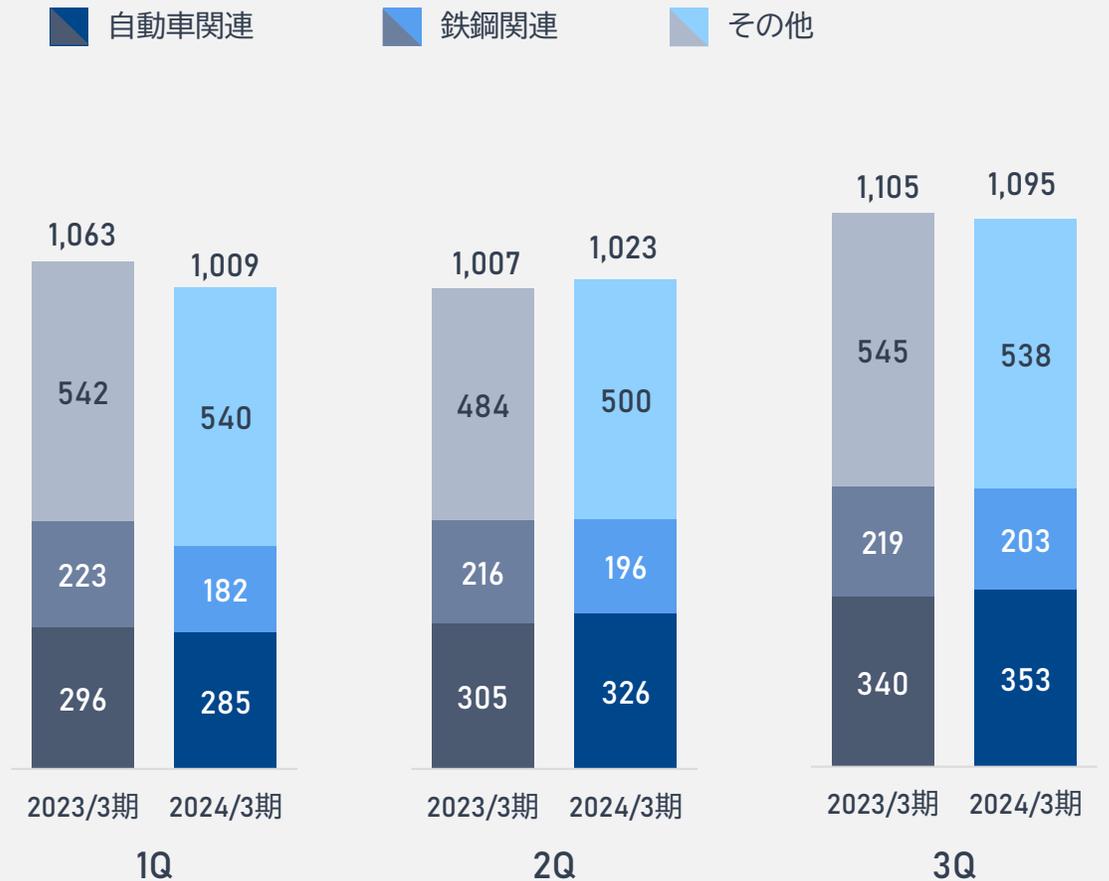
02 業績推移(製品事業内訳)

- ハイテク関連製品は本第3四半期においては、HDD関連、光ファイバー関連が上半期に比べて弱含みながら回復傾向です。
- 一般研磨関連製品の累計売上高は、前年同期比較で安定的な推移であり、自動車関連では僅かながら増加傾向です。

ハイテク関連製品(単位:百万円)



一般研磨関連製品(単位:百万円)

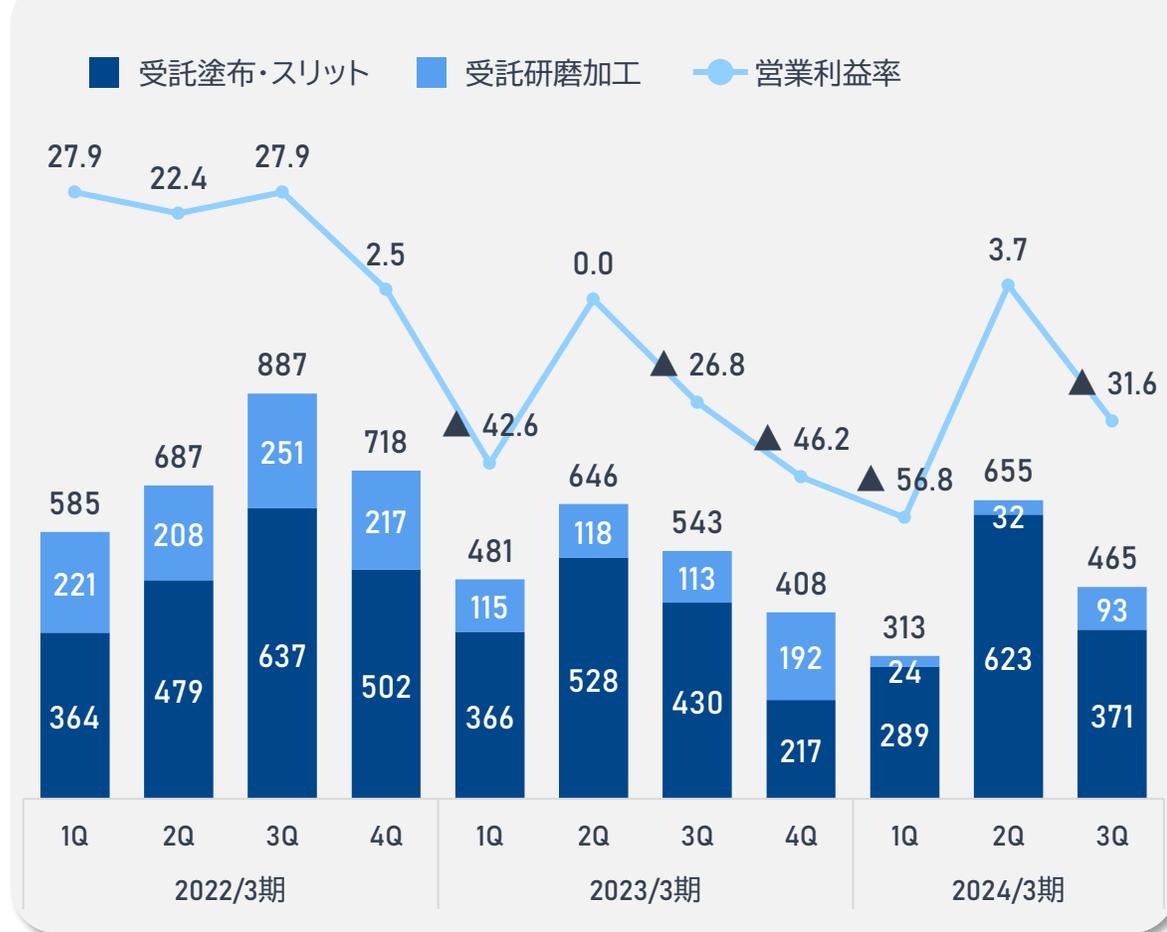


※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

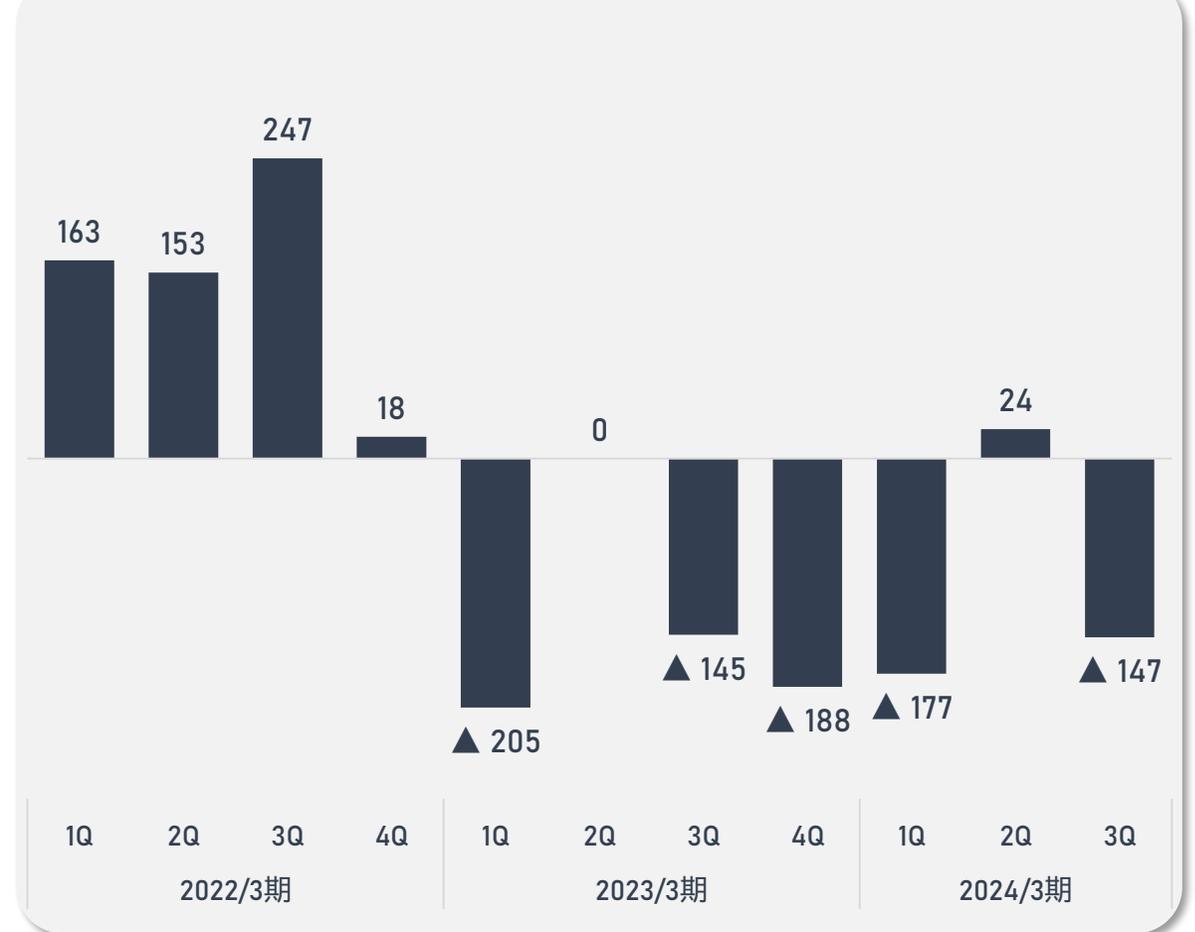
02 業績推移(受託事業)

- 受託塗布・スリットは季節性の影響もあり第3四半期の売上高は減少傾向です。
- 受託研磨加工は先端材料の受託量が増加しており、また、第3四半期から連結子会社となった大久保鉄工所の売上高も加算されています。
- 受託塗布・スリットの売上高の減少影響により、営業損失を計上しています。

売上高・営業利益率(単位:百万円・%)



営業利益(単位:百万円)



※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

(単位:百万円)	2023/3期末	2024/3期 12月末	増減額	備考
流動資産合計	9,032	8,974	▲57	
現金及び預金	2,613	2,829	+216	
売上債権※	2,385	2,761	+376	
棚卸資産	3,127	3,082	▲44	
その他	908	300	▲608	税金関連還付金受領による減少
固定資産合計	7,162	7,175	+12	
有形固定資産	6,663	6,609	▲54	京都工場の売却、インドの工場取得等含む
資産合計	16,195	16,149	▲45	
流動負債合計	5,065	4,837	▲228	
支払手形及び買掛金	793	713	▲80	
短期借入金(社債含む)	2,930	2,542	▲387	長期借入金への切替え
未払金	664	755	+91	
その他	376	513	+137	
固定負債合計	3,131	3,837	+705	
長期借入金(社債含む)	2,867	3,475	+607	新たな長期借入による財務基盤の安定化
負債合計	8,197	8,674	+477	
純資産合計	7,997	7,474	▲522	
負債純資産合計	16,195	16,149	▲45	

※売上債権は受取手形、売掛金、電子記録債権を合計し、棚卸資産は商品および製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品を合計しております。

※増減算出後、百万未満切捨て

リリース日	該当四半期	タイトル	詳細
2024年1月29日	4Q	高精度アライメントシステムを採用した常温接合加工サービスを開始	P18
2024年1月23日	4Q	海外子会社の移転に関するお知らせ	別途資料
2023年12月26日	3Q	足利銀行による「ポジティブ・インパクト・ファイナンス」評価書が公開されました	P17
2023年11月24日	3Q	海外子会社の工業用地および建物の取得に関するお知らせ	別途資料
2023年11月13日	3Q	出展情報「2023未来創造展」	別途資料
2023年10月31日	3Q	有限会社大久保鉄工所の全株式の取得(子会社化)に関するお知らせ	別途資料
2023年10月30日	3Q	Mipox京都工場閉鎖のお知らせ	別途資料
2023年10月24日	3Q	IH(高周波誘導加熱)粉体塗装システム ラボ新設	別途資料
2023年10月18日	3Q	出展情報「SWTest Asia 2023」	別途資料
2023年10月16日	3Q	出展情報「2023 Korea Electronics Show」	別途資料
2023年9月12日	2Q	出展情報「Digital Printing Expo 2023」	別途資料
2023年9月5日	2Q	展示会「SEMICON Taiwan 2023」でMipoxのクリーニングシートご紹介	別途資料
2023年9月4日	2Q	出展情報「第21回中国国際光博会(CIOE 2023)」	別途資料
2023年8月10日	2Q	名古屋大学との共同研究成果が論文として掲載されました	別途資料
2023年7月11日	2Q	マツキョ×パトリック、コラボスニーカーにリフレクターブランド「Ref Lite(レフライト)」が採用	別途資料
2023年4月27日	1Q	米国インターナショナル・テスト・ソリューションズ社の契約解除に関するお知らせ	別途資料

足利銀行による「ポジティブ・インパクト・ファイナンス」評価書が公開されました 2023年12月26日リリース

株式会社足利銀行(本社/栃木県宇都宮市)から、借入の実行による「ポジティブ・インパクト・ファイナンス」(以下「PIF」)が実行されたことをお知らせします。

～ PIF(ポジティブ・インパクト・ファイナンス)とは ～

企業活動が環境・社会・経済に与える影響(インパクト)を金融機関が包括的に分析・評価(インパクト評価)を行い、特定されたポジティブなインパクトの向上と、ネガティブなインパクトの低減に向けた取り組みを支援する融資のことです。

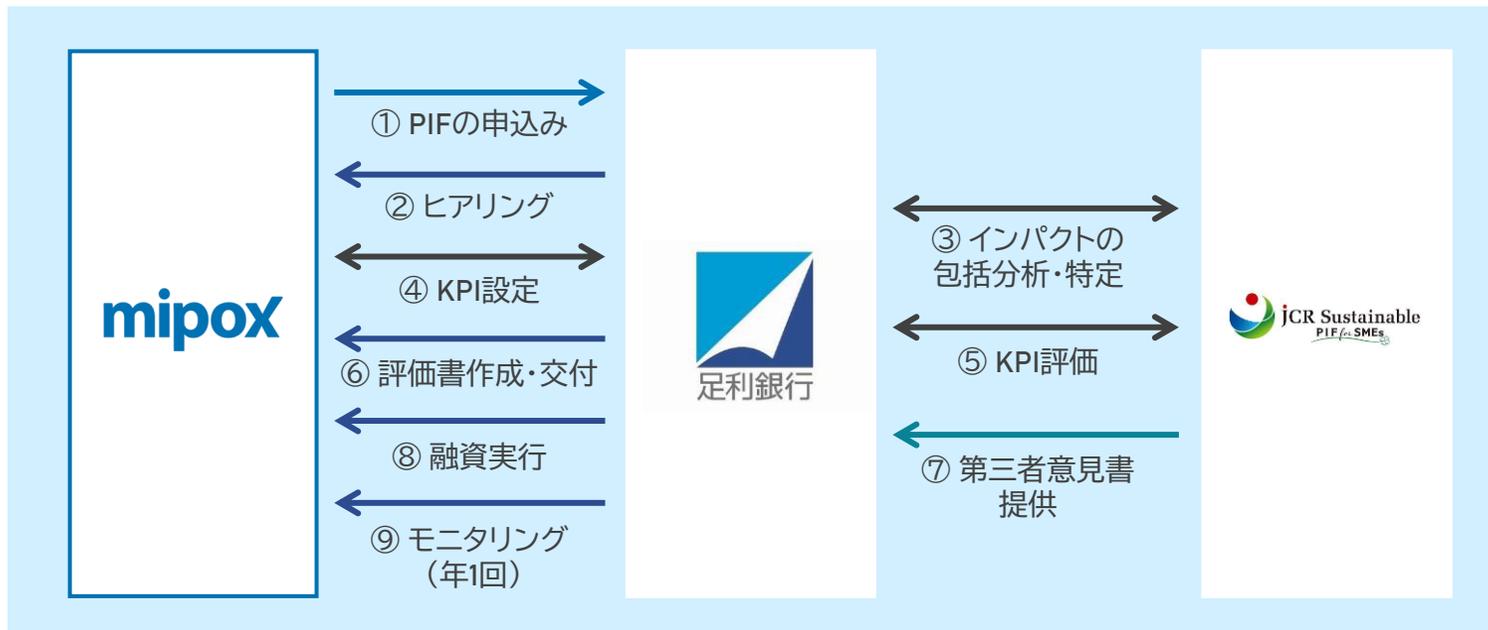
本ファイナンスの概要

金額	500,000,000円
資金使途	運転資金
実行日	2023年12月22日
モニタリング期間	5年

本件は、足利銀行が国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)^{*}の提唱するポジティブ・インパクト金融原則にもとづきインパクト評価を行い、その適合性について外部評価機関である日本格付研究所から第三者意見を取得しています。

※国連の補助機関である国連環境計画(UNEP)と金融機関の自主的な協定に基づく組織

PIF概略図

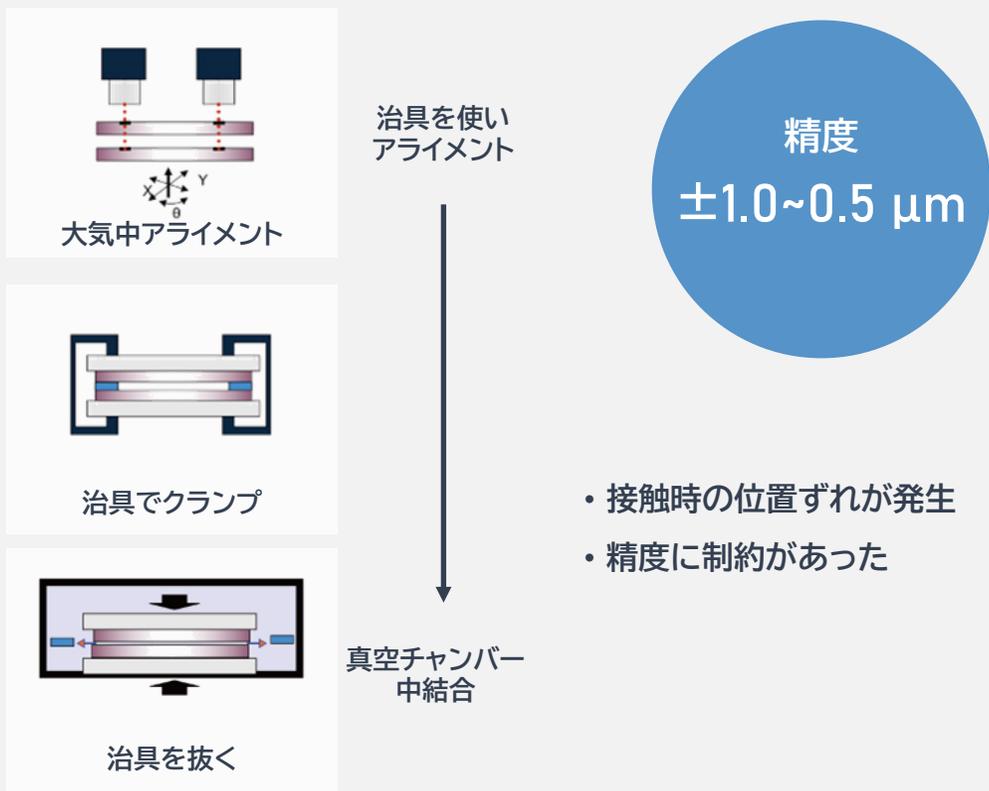


出所：足利銀行提供資料

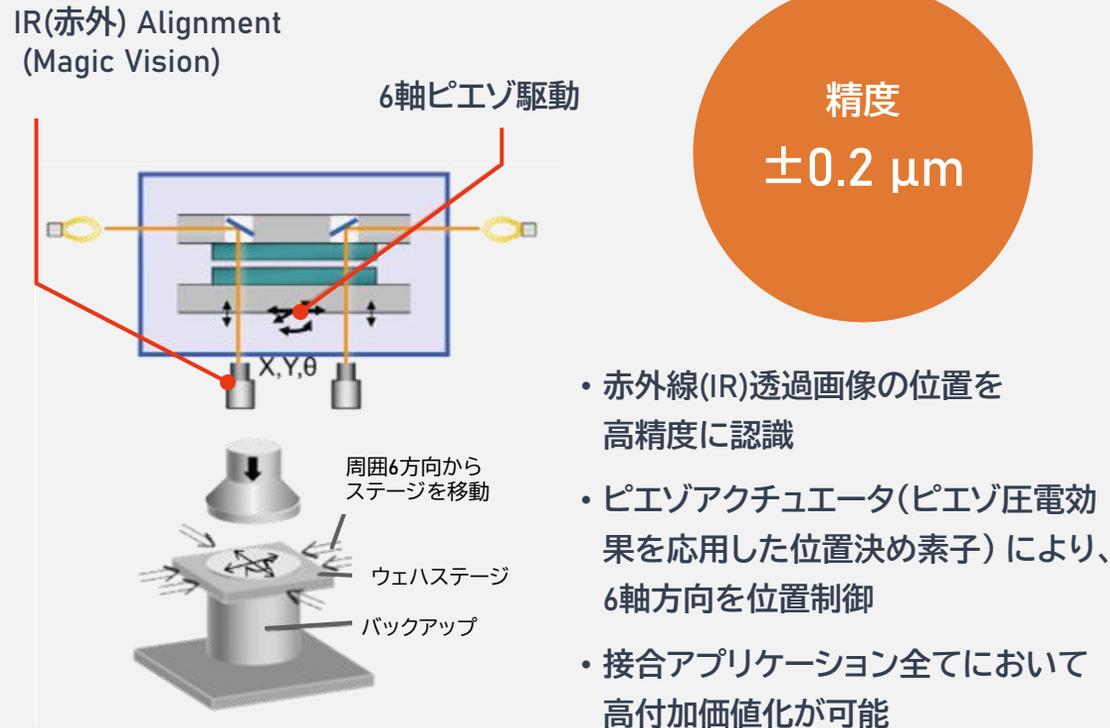
高精度アライメントシステムを採用した常温接合加工サービスを開始 2024年1月29日リリース

高精度アライメント(位置決め)システム「マジックビジョン(MagicVision:ボンドテック株式会社開発)」を用いた接合加工サービスの提供を新たに2024年2月1日より開始いたします。これにより、MEMS(微小電気機械システム)、ハイブリッド接合、半導体向け3次元積層等の先端技術への対応が可能となります。

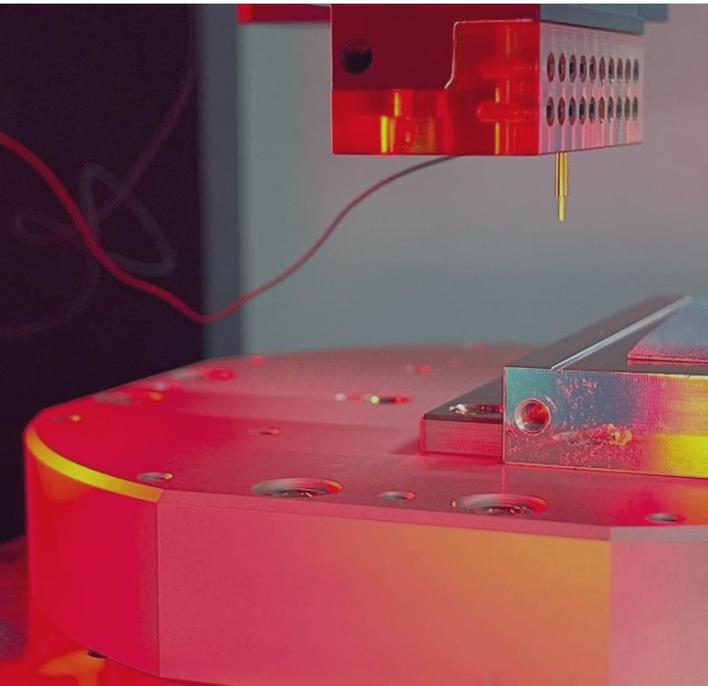
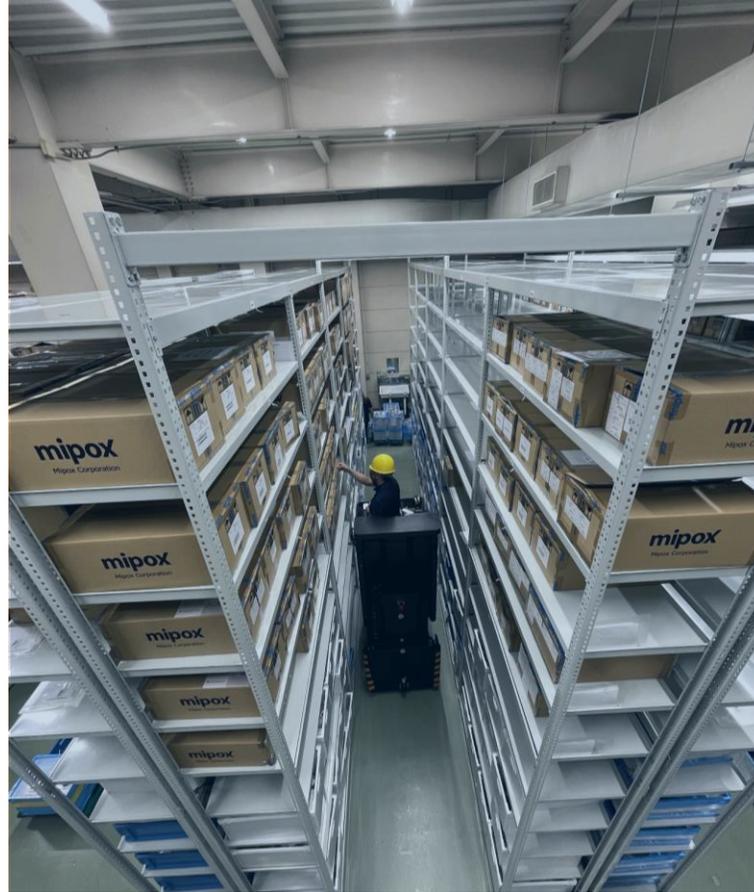
従来のアライメント方法



高精度アライメントシステム採用後



Agenda



- 01 会社概要
- 02 2024年3月期第3四半期 実績
- 03 通期業績見通し**
- 04 事業内容
- 05 競争力の源泉
- 06 成長戦略
- 07 Appendix

(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益
当初予想(A)	10,500	500	600	500
修正予想(B) (2023年11月13日リリース)	9,000	▲700	▲500	▲600
2023年3月期実績	10,029	213	426	45
増減額(B-A)	▲1,500	▲1,200	▲1,100	▲1,100
増減率	▲14.3%	-	-	-

※増減算出後、百万未満切捨て

コメント

- 2023年3月期下期から続く、PC・タブレット製品等の電子デバイス市場やデータセンター向け投資の抑制が、期初時点の予想よりも長期化しております。第3四半期から一部の用途は回復基調にありますが、当該市場の動向は当社のハイテク関連製品や受託事業への影響が大きく、前回発表予想を売上高および各段階利益で下回る見込みです。
- 売上高は前回発表予想を1,500百万円(約14.3%)下回る見通しです。また、利益についてはタイ子会社閉鎖に伴い、移管した製品在庫に係る評価損の計上等があったものの、物流コストや外部倉庫解約等の費用減少もあり、営業損失は700百万円を予想しております。
- 為替差益や受取賃借料の計上、京都工場閉鎖に伴う特別利益の計上等がある一方で、繰延税金資産の回収可能性の見直し等もあり、経常損失は500百万円、親会社株主に帰属する当期純損失は600百万円を予想しております。

ハイテク関連製品

- 2024年3月期期初時点からハードディスク関連および半導体関連市場の低迷が予想されておりました。これら用途向け売上高は2024年3月期第1四半期を底としており回復傾向にありますが、通期では引き続き弱含みの状態です。
- 光ファイバー関連市場は第3四半期から顧客の在庫調整が一巡し、回復傾向がみられます。また、ハードディスク関連市場においても、同様の傾向はみられ始めており、現時点では弱含みであるものの今後の更なる回復が期待されます。

一般研磨製品

- 全般的に底堅い需要がある製品用途であり、引き続き売上高は安定的に推移することを見込んでおります。一方、原材料やエネルギー費用の高騰は継続しており、利益率は低下傾向です。昨今の社会情勢を鑑みた各種製品の値上げを順次進めております。
- 景気後退が進む海外市場ではありますが、活発な建設需要が引き続き期待されるインドに新工場を設立しました(2023年11月)。インド拠点では、従来の自動車関連用途向け研磨製品に加えて、新たに橋梁や建設関連向けの研磨製品の開発と生産を進め、さらに一般研磨製品の需要の拡大に努めてまいります。
- 2023年3月に取得した溶剤フリーのIH粉体塗装事業の営業展開と一般研磨関連製品への技術転用の研究を継続いたします。販売網の拡充を図るため鹿沼事業所の実証実験ラボを活用し、パートナー企業の増加を通じて顧客獲得を目指す営業戦略を展開してまいります。

受託塗布・スリット

- 新規顧客開拓を進め、試作件数が増加しております。これら試作による来期以降の量産の獲得や新たな用途向け顧客の拡大を図って参ります。
- 発注元からの受託量の減少もあり、既存の受託塗布・スリット案件の受託売上が減少傾向です。

受託研磨加工

- 2024年3月期は受託量が減少し、来期の受注に向けた試作案件の活動に注力しております。オウンドメディアである「研磨ラボ」や国際学会であるICPTでの露出を通じ、海外顧客からの認知度向上と新規の受託先開拓に努めてまいります。
- 欧米メーカーの最新xR領域デバイスに用いられる先端材料の加工等の実績を積み上げており、GaN縦型デバイスの実現に向けた接合案件等も増加しております。また、海外ウェーハメーカーからの加工依頼が多い、SiCやGaN、ダイヤモンドを代表とした次世代半導体ウェーハの研磨材(スラリー・研磨フィルム)や専用研磨装置の開発を進めております。
- 高精度アライメントシステムを採用した常温接合加工サービスを開始し、MEMS(微小電気機械システム)、ハイブリッド接合、半導体向け3次元積層等の先端技術への案件の獲得に努めてまいります。
- 新たにグループ会社となった大久保鉄工所による金属精密研磨加工領域の規模拡大を引き続き進めてまいります。

年間配当

2023年3月期

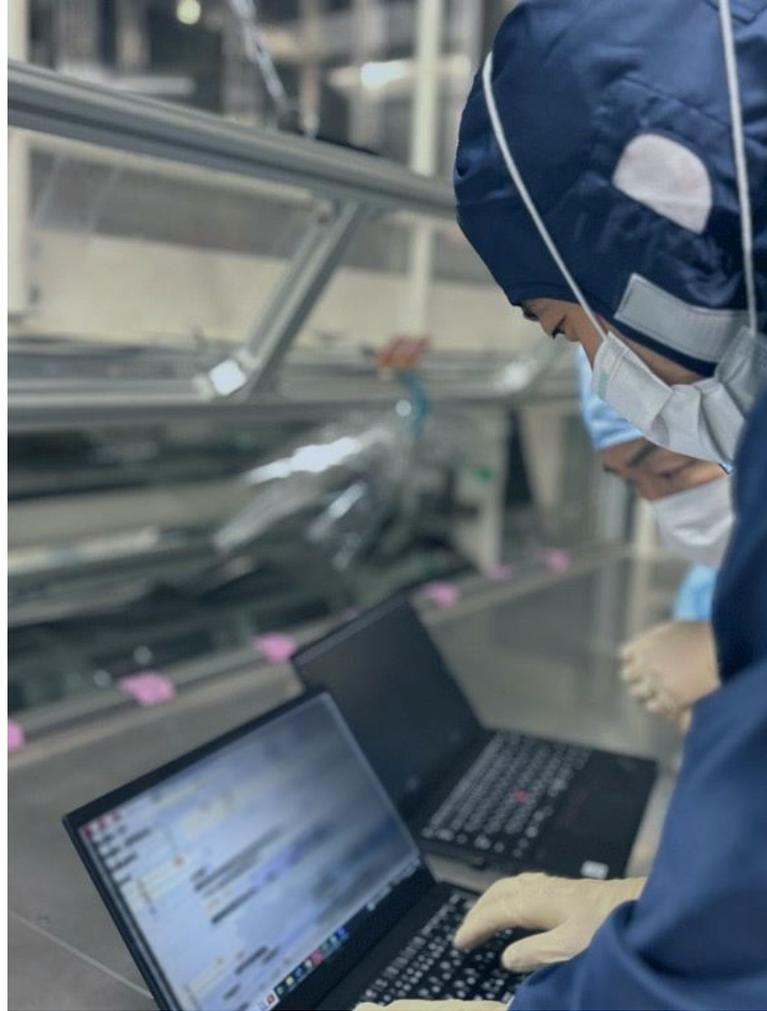
10円

2024年3月期

無配

将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保するとともに、株主の皆様に対しては安定配当を目指しつつ、業績等を勘案して、適正な利益還元に努めておりますが、当初予想より大幅に下回る見通しとなっております。そのため、誠に遺憾ではございますが、2024年3月期の期末配当の実施を見送らせていただくことといたしました。

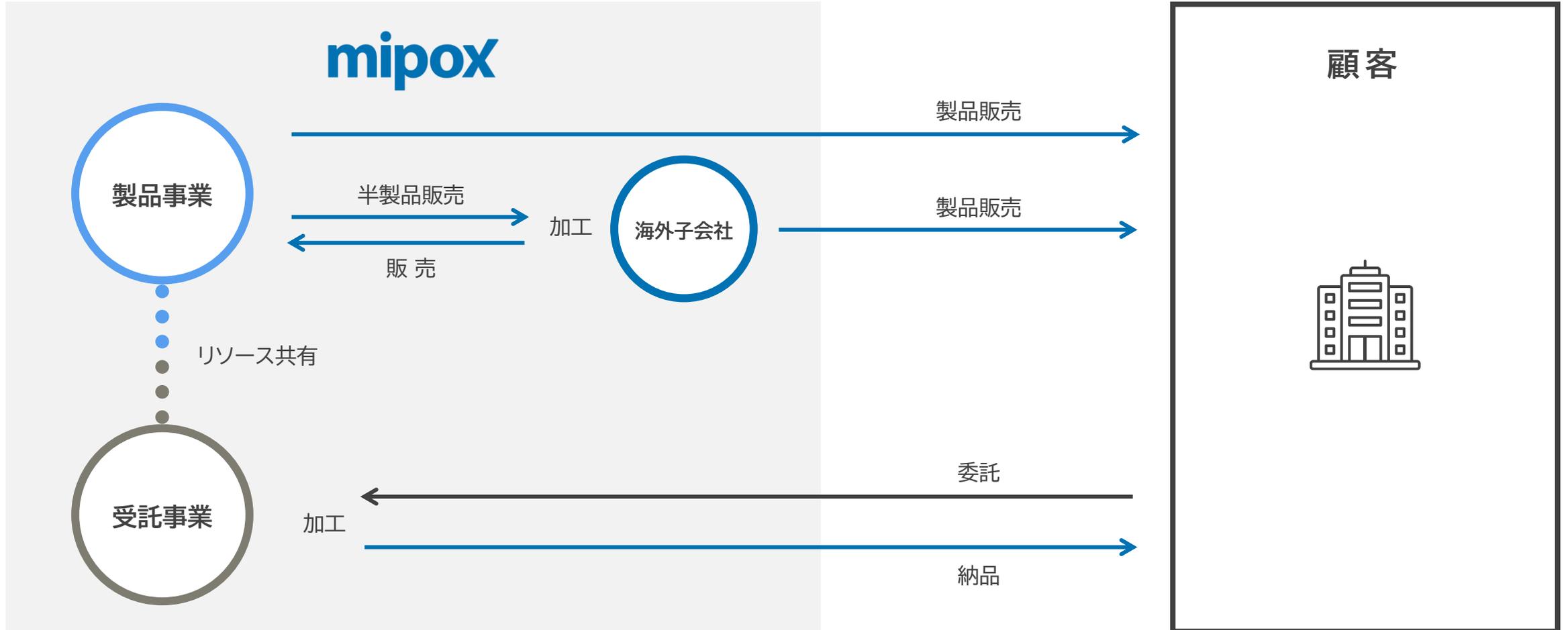
Agenda



- 01 会社概要
- 02 2024年3月期第3四半期 実績
- 03 通期業績見通し
- 04 事業内容**
- 05 競争力の源泉
- 06 成長戦略
- 07 Appendix

04 事業系統図

- 海外工場での加工を経ることにより、日本のみに工場が存在するよりも様々な製品を効率よく製造しております。海外向けに販売も行っております。
- 顧客からの委託を受けて加工も行っており、自社製品のみならず顧客の要望に合わせたサービス・製品も提供しております。



製品事業

研磨材の開発・製造・販売を行っております。
超精密研磨から一般研磨、装置や反射材など、世界中の幅広い用途に向けて
当社製品を提供しております。



研磨フィルム



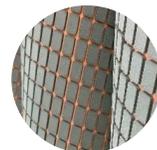
液体研磨剤



研磨関連製品



研磨布紙製品



研磨砥石製品



研磨周辺機器



検査装置

再帰性反射材
(Ref Lite)

ヤスリ製品



IH粉体塗装

受託事業

【受託研磨加工】

半導体ウェーハをはじめとする材料を顧客より預かり、弊社が保有する設備
(研磨装置、洗浄機、検査装置)と独自の研磨材を用いて、要望に沿った研磨
加工を提供しております。

【受託コーティング・スリット】

顧客の基材(フィルム等)や塗料材を預かり、弊社が保有する設備(調合、
コーティング、スリット)を用いてフィルム化、裁断を行っております。



塗布製品



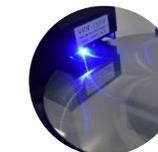
研磨加工



スリット加工



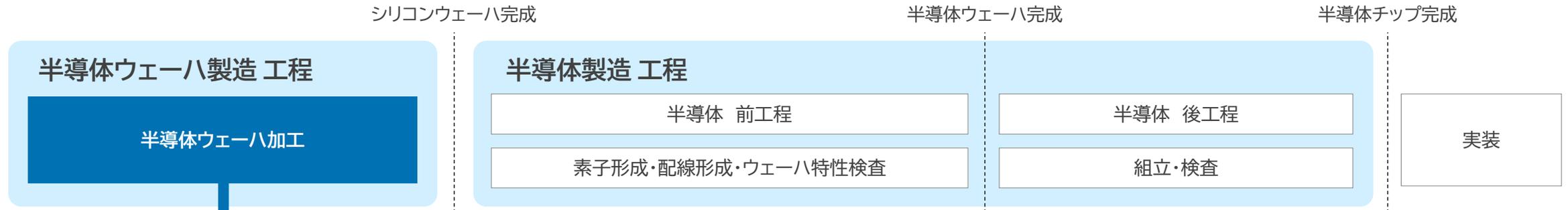
常温接合加工



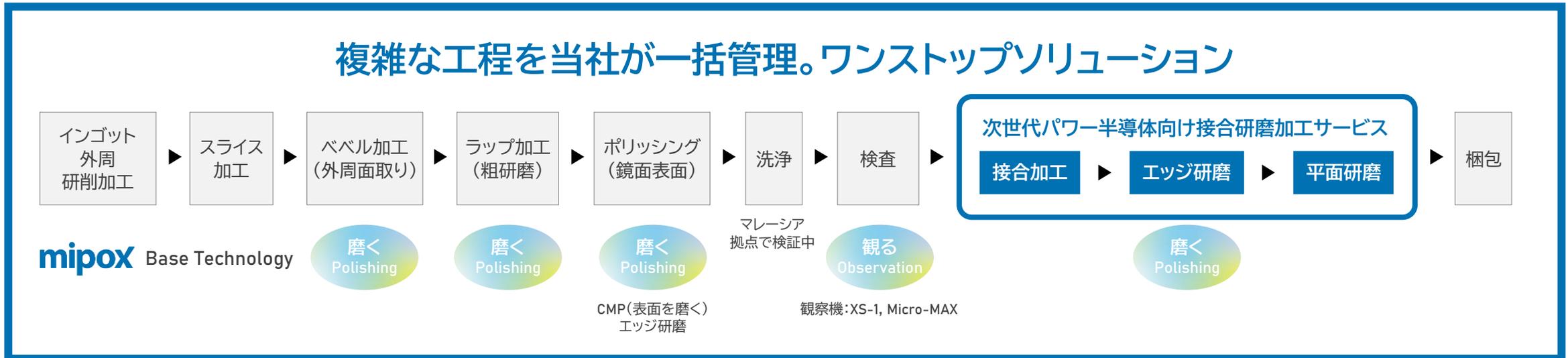
検査

04 サプライチェーン(半導体ウェーハ製造工程の例)

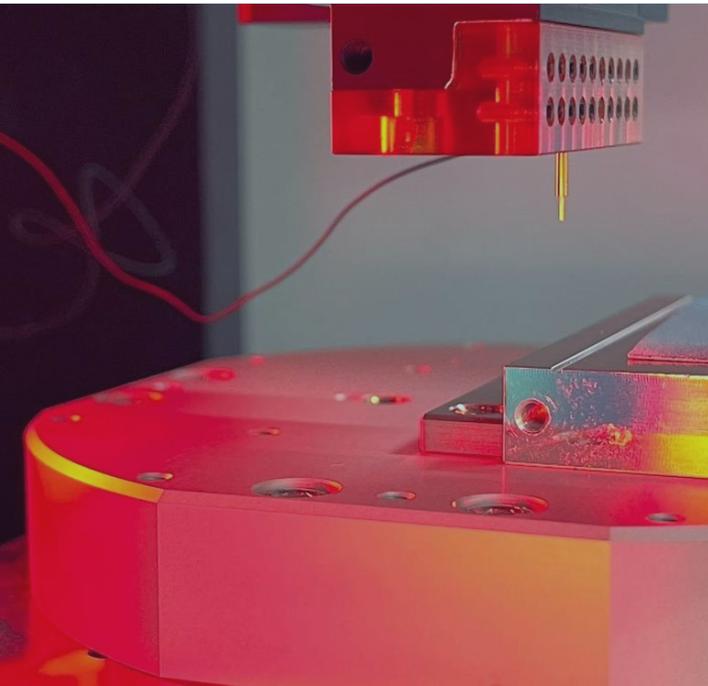
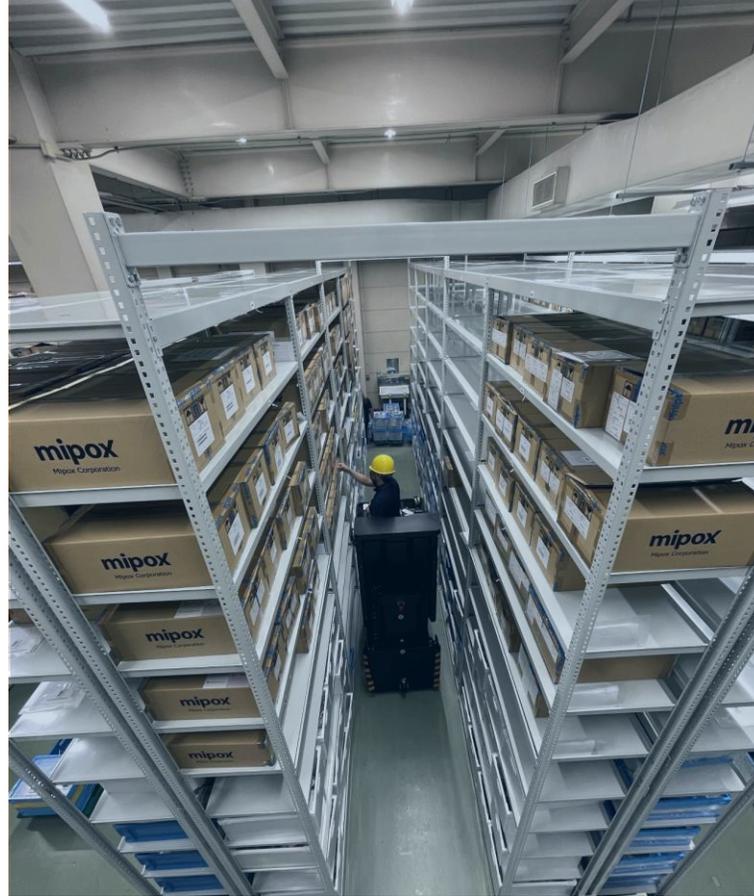
- 様々な工程を経る半導体製造工程において、当社はシリコンウェーハ加工におけるほぼすべての工程が作業可能です。
- 現在は次世代パワー半導体の量産に向けた国家プロジェクトにも参画しております。(P38、39参照)



半導体ウェーハ加工工程



Agenda



- 01 会社概要
- 02 2024年3月期第3四半期 実績
- 03 通期業績見通し
- 04 事業内容
- 05 競争力の源泉**
- 06 成長戦略
- 07 Appendix

1 事業間で発揮されるシナジー効果

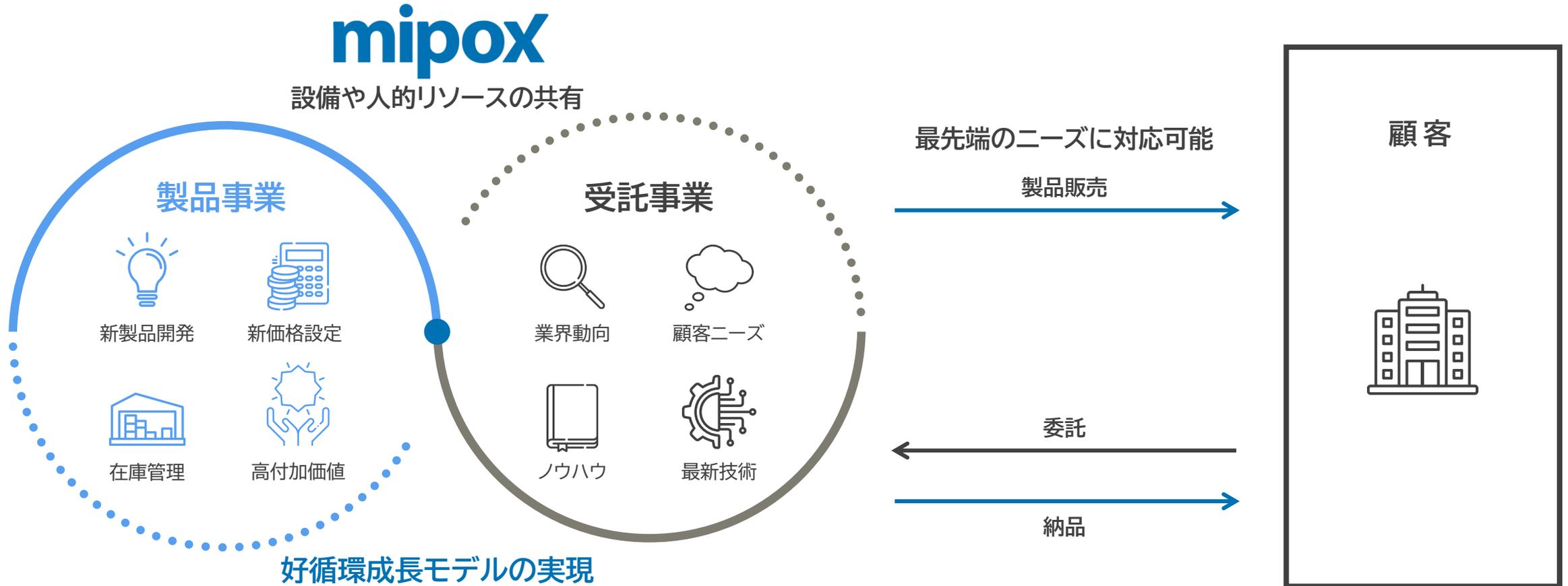
2 顧客の要望に合わせた高品質な製品の提供

3 スマートファクトリー

05 競争力の源泉① 事業間で発揮されるシナジー効果

- 製品事業と受託サービス事業では設備や人的リソースを共有しており、技術やノウハウの蓄積に役立っております。
- 蓄積された技術やノウハウは高付加価値のある製品やサービスの創出に活かされ、顧客の多様な要望を実現する源になっております。

製品事業と受託事業の共有型リソース



05 競争力の源泉② 顧客の要望に合わせた高品質な製品の提供

- 製品製造と受託加工ができるため、顧客の理想に合わせた製品の作成、きめ細やかなサービスの提供が可能です。
- 各製造工程において異なる取引先との煩雑なやりとりを当社がワンストップで提供しており、顧客の要望が1つの窓口で完結いたします。



05 競争力の源泉③ スマートファクトリー

- IoTとAIを活用し連携させることで、可視化しづらい部分の改善に役立つデータを収集しております。
- 工場のDX化により、さらなる効率化・高品質化を目指します。

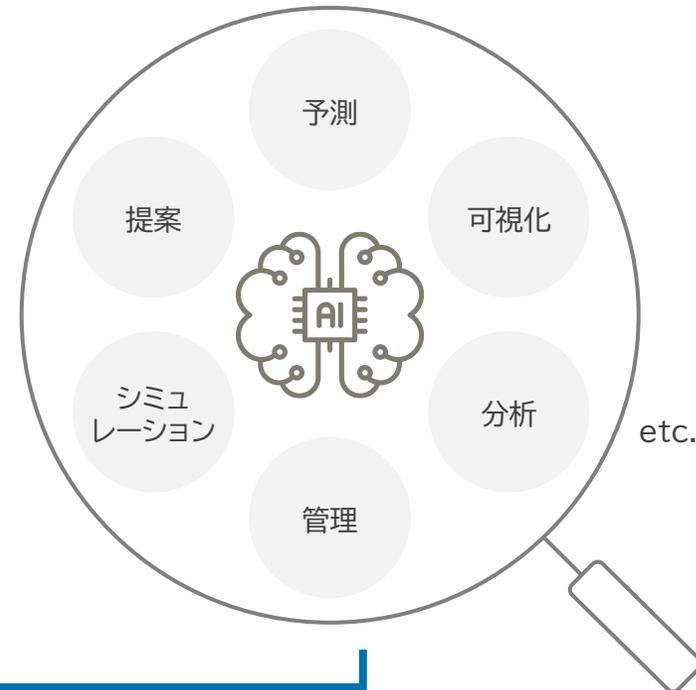
IoT

あらゆる機器を連携させ、様々なデータを収集・蓄積



AI

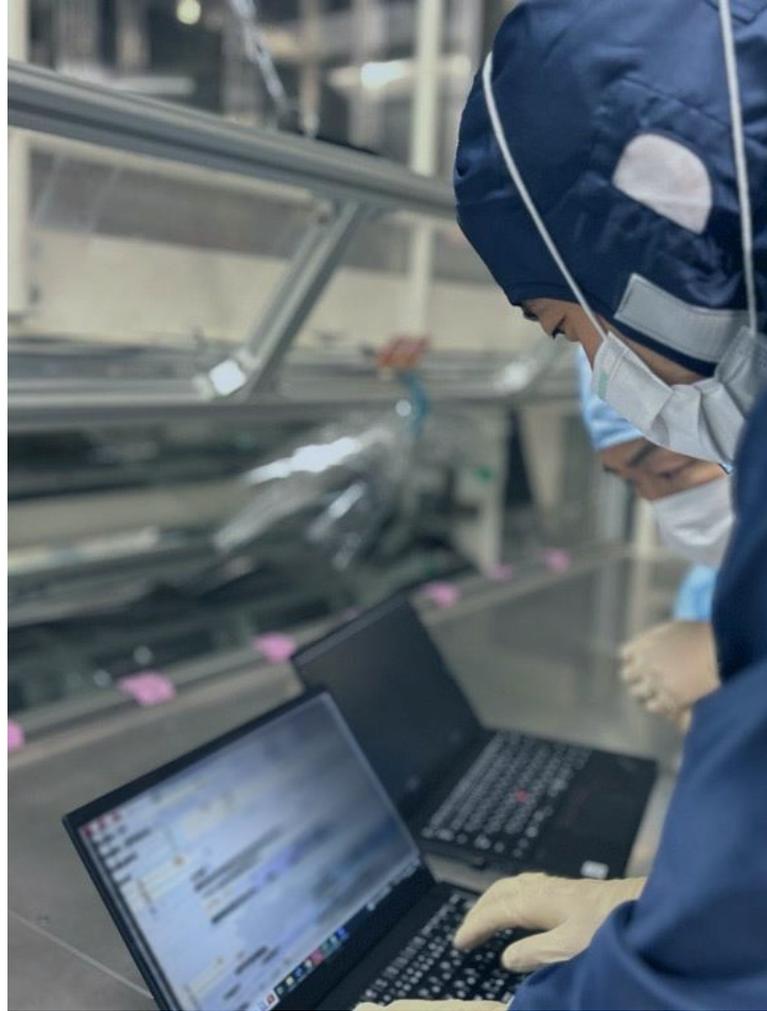
IoTで集めたデータを分析して課題を見える化



業務プロセスの改革

品質・生産性の向上

Agenda



- 01 会社概要
- 02 2024年3月期第3四半期 実績
- 03 通期業績見通し
- 04 事業内容
- 05 競争力の源泉
- 06 成長戦略**
- 07 Appendix

1 製品・受託事業領域の拡張

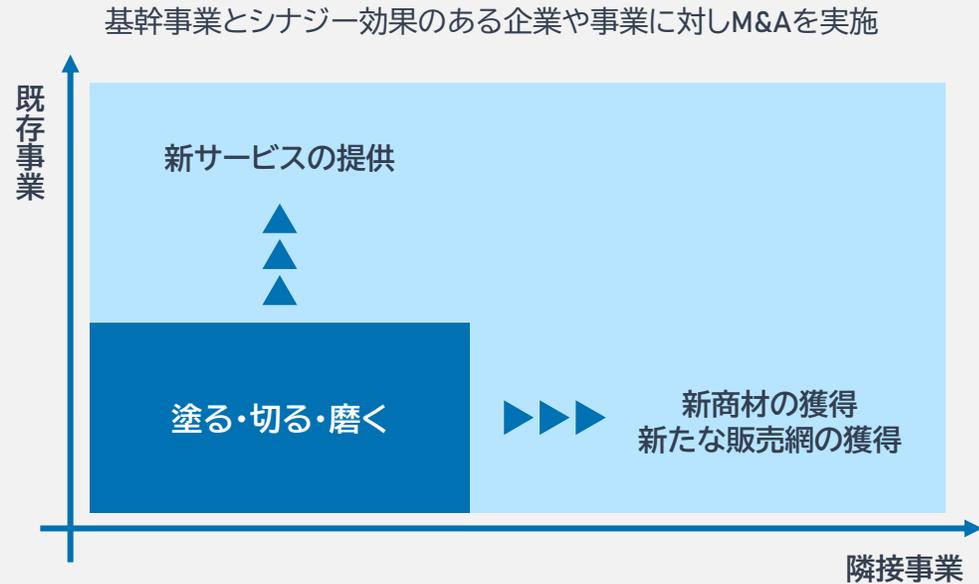
2 鹿沼事業所の量産体制構築

3 産官学プロジェクトへの参画

06 成長戦略① 製品・受託事業領域の拡張

- 当社の基幹技術「塗る」「切る」「磨く」の事業領域を拡大するための打ち手として、M&Aを実施してまいりました。
- 今後も製品・受託事業領域の拡張を行ってまいります。

M&Aに対する基本的な考え方



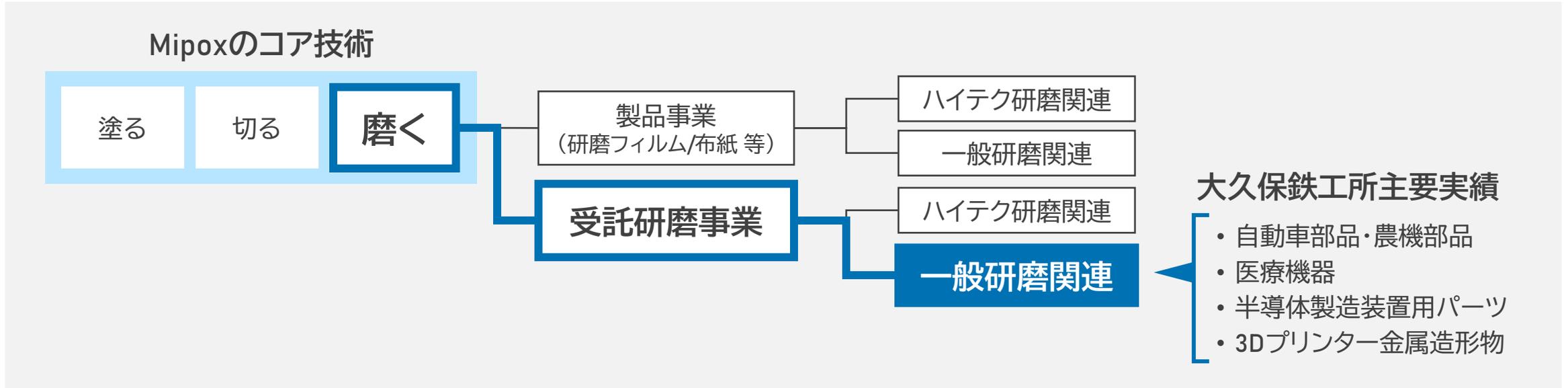
これまでのM&A実績

 反射材製品、精密研磨フィルム等の製造・販売 (2015年)	 研磨布紙及びその他研磨材製商品の製造・販売 (2016年)	 フレキシブル・超高品質なヤスリの開発・製造 (2021年)
 研磨ディスクの製造・販売 (2022年)	 スガ コーディングス 有機溶剤不使用のコーティング事業 (2023年)	 大久保鉄工所 金属パーツの精密研磨加工 (2023年)

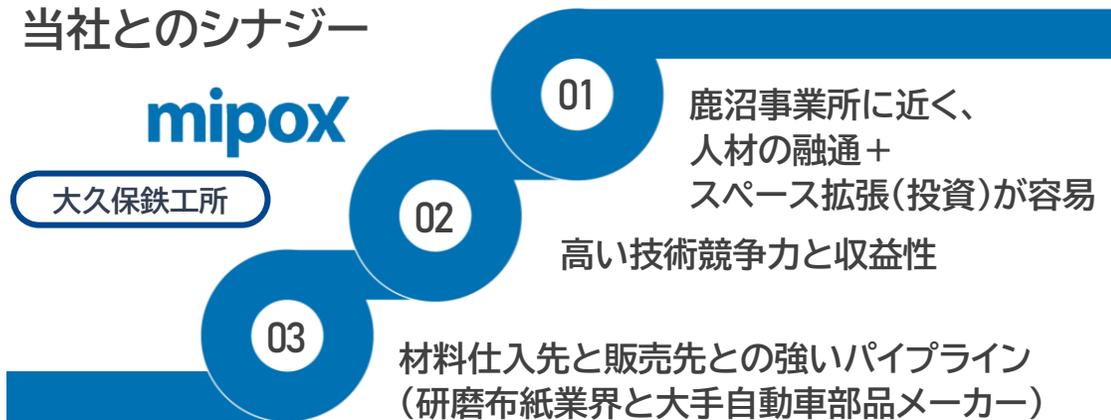
多様化するニーズに、迅速且つ的確に対応できる体制の構築

06 成長戦略① 製品・受託事業領域の拡張 -大久保鉄工所の参画-

- 2023年10月31日に大久保鉄工所をM&Aにて取得、これにより当社の主要事業すべてにおいて一般研磨用途の参入が可能となり、さらなる対象市場の拡大と新規顧客の獲得が期待されます。



当社とのシナジー



今後の展望

- 受託研磨事業の対象市場拡大 (自動車・農機・医療・3Dプリンター業界など)
- Mipoxの営業ネットワークを活用した新規顧客の獲得



06 成長戦略② 鹿沼事業所の量産体制構築

- 2023年4月より本社を東京オフィスから鹿沼事業所に移転し、本格稼働を開始いたしました。
- 今後、計画的に人員・設備・機械の増強を行いながら、更なる生産能力の拡大に努めてまいります。

鹿沼事業所

敷地面積:約60,000㎡
延床面積:約46,000㎡

取得日

2022年4月1日

取得目的

受託事業の生産能力拡大
事業成長のための場所確保
BCPの観点から生産体制のリスク分散



受託研磨加工

スリット工程

塗布工程

環境配慮設備

ダイカット工程

物流

鹿沼事業所の稼働状況

- 受託塗布・スリットの稼働を開始
- タイ子会社、京都工場からの生産移転
- (株)スガコーディングスのIH塗装事業の稼働開始
- 東の物流拠点としての機能を集約
- 使用面積増加も可能(未使用エリアは他社へ貸与中)

研磨ラボの活用

顧客と一体で研磨プロセス、製品開発を進められる体制を構築し、初期ニーズの把握を行い、付加価値が高く迅速な製品提供を展開予定



06 成長戦略③ 次世代半導体プロジェクト (当社参画のプロジェクト一覧)

- 3つのNEDOプロジェクトに参画しております(うち1プロジェクトはすでに終了)。
- 加工技術と評価技術の確立においてさまざまな組織と協力し、国主導のプロジェクトを進めております。

PROJECT 01

NEDOグリーンイノベーション基金事業 -次世代デジタルインフラの構築-

オキサイドを幹事会社として(株)UJ-Crystal、国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学、アイクリスタル株式会社、国立研究開発法人産業技術総合研究所が参画

- 大口径ウェーハ用ラインの開発に向け、8インチSiCウェーハの詳細な加工工程フロー(第一次案)を作成し、加工ラインに必要な各装置の仕様を決定。
- 装置選定、発注を順次実施中。下期には設置完了を予定。

加工技術

大口径SiCウェーハ加工ラインの開発

8インチ対応SiCウェーハ加工、パイロットラインの構築

ウェーハ加工工数の削減

加工シミュレーションの検討と削減工程候補の抽出

評価技術

溶液法におけるSiC結晶の評価技術確立

溶液法SiCに適した光学系の最適化とそれに基づく装置設計

大口径ウェーハ観察装置の開発

8インチウェーハに対応した装置使用の検討と設計

PROJECT 02

NEDO官民による若手研究者発掘支援事業

名古屋大学(原田俊太准教授)

- 当社の装置XS-1 Siriusを使用して、デバイス特性に影響を及ぼすことが懸念される転位欠陥を判別できる技術を開発。これまでの研究結果は、国際会議や学術論文において発表済みであり、デバイスメーカーからも高い関心を集めている。
- 下期以降は、デバイスメーカーとの連携を深め、デバイス不良との相関についてさらに研究を推進。

評価技術

半導体製造の生産性を向上させるキラークラック欠陥
自動検査システムの開発 [2023年8月論文発表](#)

PROJECT 03

NEDOマテリアル革新技术先導研究プログラム

電力中央研究所・名古屋大学(宇治原徹教授)・理化学研究所

2022年度末に終了

- 昨年度末に終了し、製品化に向けた開発を継続。

評価技術

大型SiC結晶に対する欠陥・内部歪の観察解析技術

SiCインゴット検査装置の開発

06 成長戦略③ 産官学プロジェクトへの参画(概要)

- カーボンニュートラルの実現に向けてエネルギー構造や産業構造の転換、大胆な投資によるイノベーションの創出が必要とされています。
- これまでの社会の延長にない飛躍的な目標を達成するため創出された、グリーンイノベーション基金のプロジェクトに当社が参画しております。

NEDO※1グリーンイノベーション基金

- 日本政府が主導する「2050年カーボンニュートラル」宣言を達成するための基金
- 事業予算2兆円
- カーボンニュートラルに向けた研究開発、実証から社会実装に取り組む企業に最長10年間支援

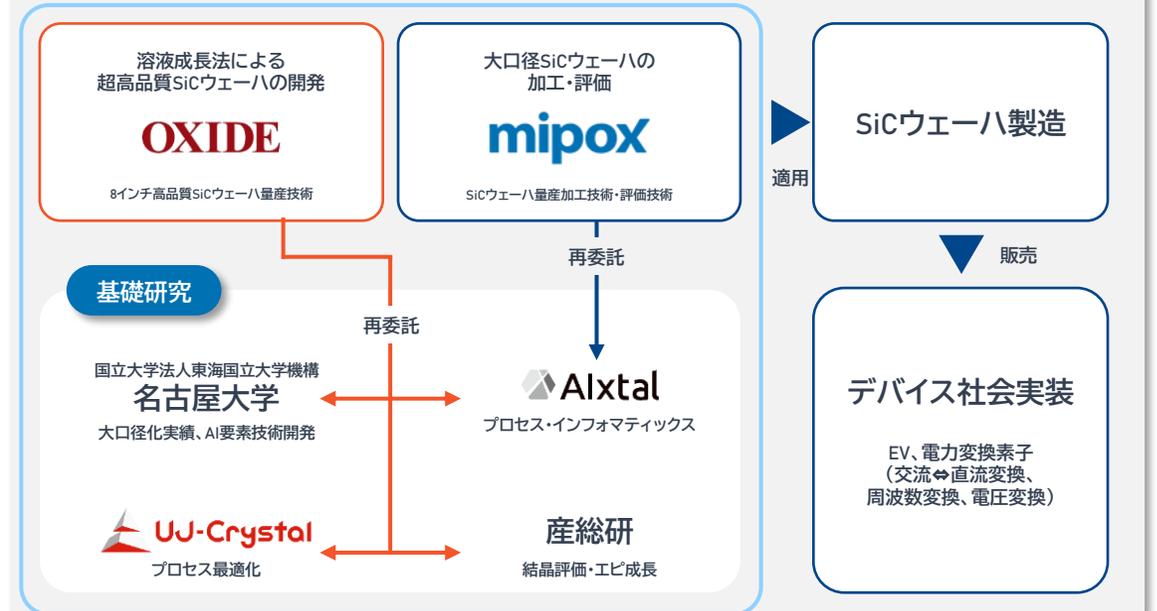


※1: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

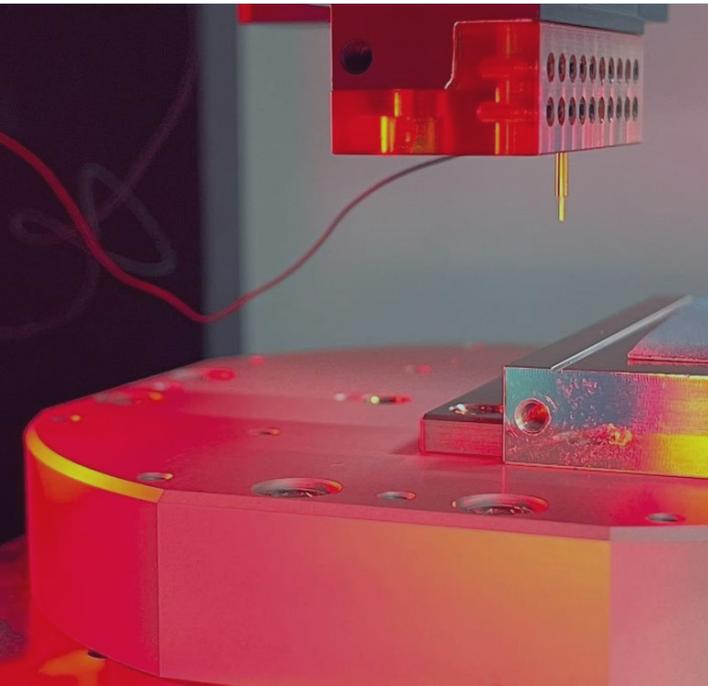
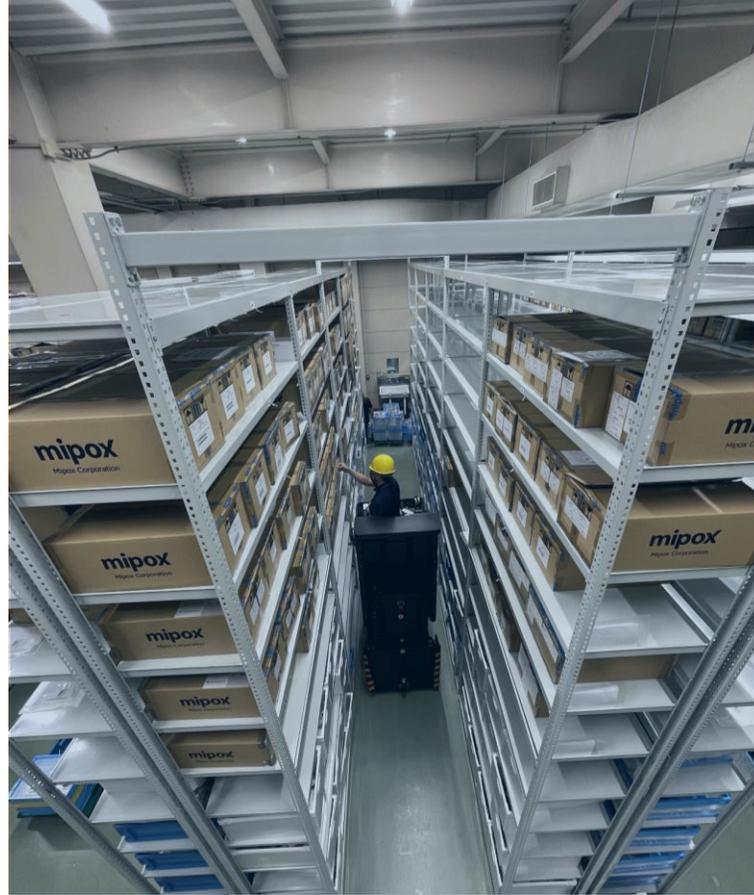
プロジェクトの目的

超高品質・8インチ・低コストSiCウェーハ開発・販売

系統図



Agenda



- 01 会社概要
- 02 2024年3月期第3四半期 実績
- 03 通期業績見通し
- 04 事業内容
- 05 競争力の源泉
- 06 成長戦略
- 07 Appendix

変わることを忘れない『100年ベンチャー』

当社は1925年にドイツ・レイボルト商館の子会社として創業し、輸入した顔料を販売する傍ら主に出版物に使われる色箔の製造を生業としておりました。1960年代後半よりこの色箔を製造する中で培った「塗る」技術、それを裁断する「切る」技術を基に、精密部品の製造工程事業に使用される研磨フィルムを開発し、「塗る・切る・磨く」の3つのコア技術を確立いたしました。

精密研磨材専門メーカーとして発展を経て、2000年初頭からはコア技術である『塗る』をサービスとして提供するエンジニアリングサービス(受託塗布)を開始いたしました。創業来の危機である2008～2010年を乗り越えたあとは、『磨く』をサービスとして提供するウエハープロセス(受託研磨)を立ち上げ、「塗る・切る・磨くで世界を変える」に取り組んでまいりました。2016年には研磨布紙メーカーである日本研紙を仲間に迎え、製品事業のラインナップの拡充を進めました。

創業から間もなく100年。事業を長く続けていくために、急速に変化するテクノロジーや世の中の価値観を敏感にとらえながら、自らも変化に順応していくことが求められます。こうした時代のニーズに対応するため、わたしたちが培ってきたコア技術をさらに高めながら、新しい事業にも積極的にチャレンジし、世の中に必要とされる製品やサービスを通じて世界のお客様に選ばれるパートナーを目指してまいります。

変わることを忘れない、『100年ベンチャー』を目指してこれからも変化し続ける集団でありつづけます。

今後とも皆様のご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

代表取締役社長 渡邊淳



01



代表取締役社長 **渡邊 淳** WATANABE Jun

日本とアメリカの大学で学んだ後、1994年当社へ入社。製造現場でキャリアをスタートし、生産技術、国内営業、海外営業を担当後マレーシア駐在員、米国子会社赴任を経験。その後半導体部門長、海外支援部門長に従事。2007年取締役、2008年に先代から引き継ぐ形で現職に就任。就任後は不採算事業撤退や拠点の統廃合を通して赤字からの脱却を行った。業績回復後は製造業として「技術・品質」に加え、デジタルを企業変革の柱と据えてIT推進をリード。

02



取締役 **中川 健二** NAKAGAWA Kenji

全自動水洗い洗濯機や半導体CMP後洗浄装置の開発、ハードディスクメディアむけ研磨テープや光学検査装置の技術営業を経験。独立後は光学検査装置のマーケティングから技術、営業や貿易などに携わる。2002年に独立後、2016年当社技術本部長、2019年経営企画部長兼経営管理部長に就任。経営全般に関わりながら、社内組織体制の構築やレフタイトのリブランディング活動に注力。2021年から新事業開発に携わり、GI基金の大口径SiCウェハの加工開発を統括している

03



取締役 **上谷 宗久** UETANI Munehisa

2000年に当社入社。台湾支店長や海外子会社の代表取締役を経て、2012年取締役営業本部長に就任。製造拠点の運営、競合他社とのM&A、そして民事再生を経た企業の事業承継等を担当。2017年に退職し、ITベンチャーにおける取締役COOとしての経験をはじめ、エンジニアリング企業での事業開発責任者としての役職を経た後に、2022年4月に当社に復帰。外部活動としてthomas株式会社の社外取締役も務める。

04



取締役 **仁平 洋亮** NIHIRA Yosuke

オリックスにて国内外の事業投資や海外子会社管理等の従事。デロイトでは10年間、国内外のM&A案件のアドバイザーサービスを提供。その他、投資後のPMIや事業管理関連サービスの提供や事業再生、地方創生、AIサービス開発等に関与。デロイト在籍中に双日へ出向しクライアントの立場から国内外のM&A案件の実行をサポート。当社入社後は取締役コーポレート本部、DX本部管掌として経営管理全般を担当。

05



社外取締役（独立役員） **長井正和** NAGAI Masakazu

長瀬産業にて1973年から半導体を中心とする精密電子回路製造用機材の海外営業に25年間従事。1988年から6年間シリコンバレーに駐在し、三次元半導体パッケージ設計技術の日米企業間コラボを推進。2003年に独立し、トランスエッジ有限会社の代表として現在に至るまで主に半導体・回路板の技術・マーケティングのコンサルティングに従事。

	経営全般	グローバル 経営	ESG	DX戦略	財務・会計	研究・ 技術開発	M&A	マーケティング・ 営業	製造・ 生産技術
01 代表取締役社長 渡邊 淳	●	●	●	●			●		●
02 取締役 中川健二						●		●	●
03 取締役 上谷宗久		●		●			●	●	
04 取締役 仁平洋亮					●		●		
05 社外取締役 (独立役員) 長井正和	●	●				●		●	

Environment



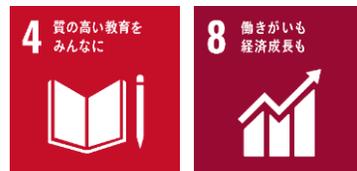
- 太陽光パネル導入の推進
- IH粉体塗装システム
- RTOの利用によるVOC削減
- LNGボイラの導入
- リサイクル素材を使用した製品の開発
- グリーンイノベーションへの取り組み
- ISO14001 にもとづいた環境負荷軽減



Social



- Eラーニングによる社内教育の充実
- スーパーフレックスタイムの導入
- 人事評価システムの構築
- 資格取得の促進および取得後の手当の充実
- 労働災害事故の防止
- 若手の定着率の向上
- 女性従業員比率の向上



Governance



- 透明性のある情報開示
- 内部通報窓口を外部企業に委託
- 全社員に対するコンプライアンス研修の実施
- グループ各社に対するガバナンスとモニタリング体制の強化



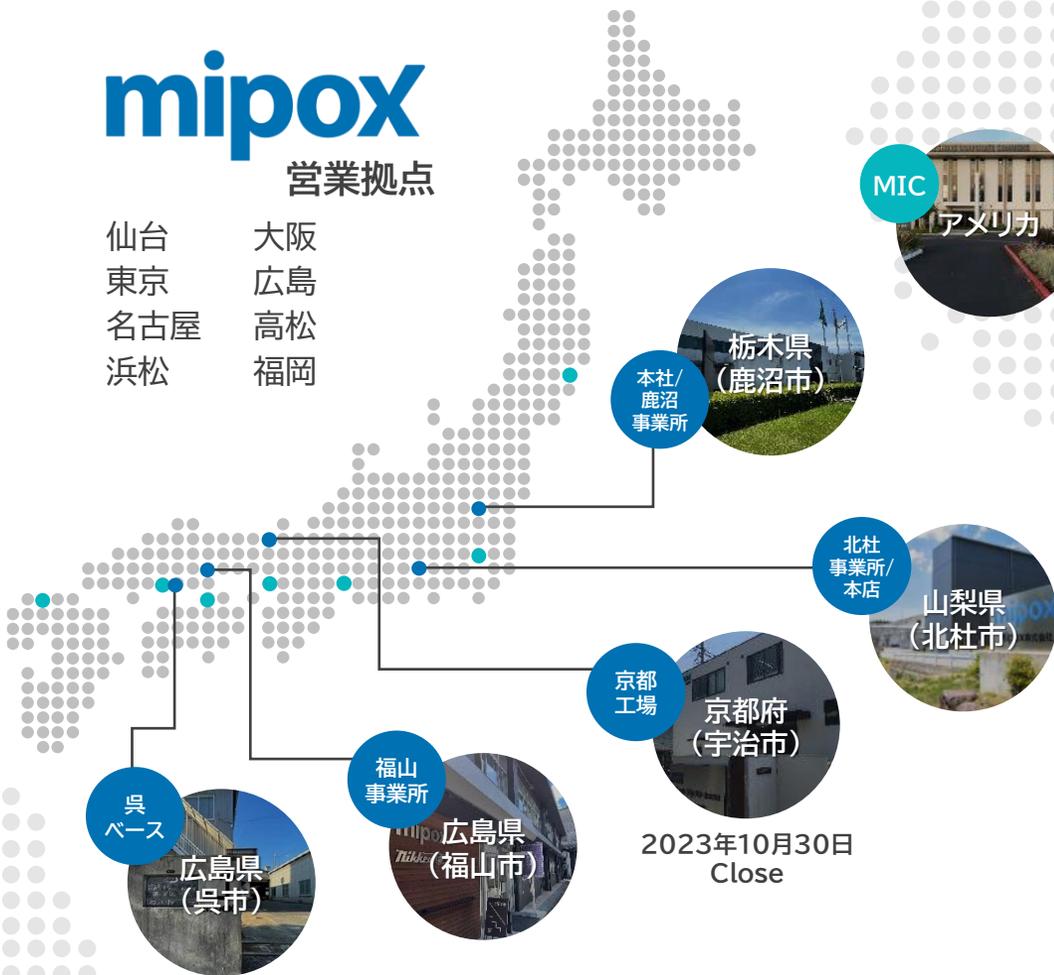
● 工場/オフィス ● 営業拠点

mipox

営業拠点

仙台
東京
名古屋
浜松

大阪
広島
高松
福岡



2023年10月30日
Close

IRお問い合わせ

<https://www.mipox.co.jp/inquiry.html>



フェアディスクロージャーの観点から、公平な情報開示体制と株主様と投資家の皆様へのお問合せ対応の維持を考慮し、IRお問い合わせ窓口のお電話での対応をおこなっておりません。HPのお問い合わせフォームをご利用ください。

